证券代码：688260　　证券简称：昀冢科技

苏州昀冢电子科技股份有限公司

SUZHOU GYZ ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.，LTD

（江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路 269 号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

国投证券股份有限公司
SDIC SECURITIES CO., LTD.

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二六年十月

公司声明

1、本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

3、中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项：

一、本次向特定对象发行股票情况

1、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经**2025 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会、2026 年 6 月 9 日召开的第三届董事会第六次会议、2026 年 6 月 30 日召开的 2025 年年度股东会、2026 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过**，尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册方案为准。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐人（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股份。

3、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易

日公司 A 股股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

调整方式如下：

派发现金股利：$P_1=P_0-D$

送股或转增股本：$P_1=P_0/（1+N）$

派发现金同时送股或转增股本：$P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中，P_0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，调整后发行底价为 P_1。

最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士在股东会的授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐人（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

4、本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 36,000,000 股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会或其授权人士根据股东会的授权结合最终发行价格与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销股票等事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。若国家法律、法规及规范性文件、监管政策变化或根据发行注册文件要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。

5、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 81,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	DPC 智能化产线技改扩建项目	18,000.00	17,050.00
2	片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目	35,000.00	25,440.00

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
3	高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目	18,993.10	18,993.10
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	**19,516.90**	**19,516.90**
合计		**91,510.00**	**81,000.00**

募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金投资金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

6、本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

7、本次发行相关决议的有效期为公司股东会审议通过之日起 12 个月。经公司 2025 年年度股东会审议通过，本次发行相关决议的有效期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的有效期届满之日起延长 12 个月至 2027 年 10 月 14 日。

本次向特定对象发行方案尚需按照有关程序向上海证券交易所申报，并最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

8、公司积极落实《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等规定的要求，结合公司实际情况，制定了《苏州昀冢电子科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。《苏州

昀冢电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已对公司利润分配政策，尤其是现金分红政策的制定及执行情况、近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况进行了说明，请投资者予以关注。

9、本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

10、发行人本次向特定对象发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的有关规定，本次向特定对象发行后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

11、本次向特定对象发行股票完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间，因此本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。为维护中小投资者的利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并起草了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺，相关情况详见《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（**二次修订稿**）的公告》。特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险，虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

12、本次向特定对象发行股票方案最终能否获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册，以及最终取得审核通过及注册的时间存在较大不确定性，提请广大投资者注意。

二、重大风险提示

本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六章 与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意投资风险，并特别注意以下风险：

（一）业绩下滑或亏损的风险

报告期内，公司净利润处于亏损状态，一方面由于新业务 MLCC 投资项目具有重资产、高技术壁垒属性，其前期厂房建设、设备购置等投入规模庞大，

伴随子公司池州昀冢在建工程转固导致折旧等相关费用大幅增加，叠加人工、材料等运营成本增加，导致公司处于亏损状态；另一方面，公司消费电子业务有所下滑，期间费用较高，进一步加剧了业绩亏损的情况。

如果发生市场竞争加剧、宏观景气度下行、需求持续低迷、国家产业政策变化、公司不能有效拓展客户、公司无法继续维系与现有客户的合作关系等情形，且公司未能及时采取措施积极应对，将使公司面临一定的经营压力，存在业绩下滑、持续亏损的风险。

（二）竞争加剧的风险

公司所处其他电子元件制造业产品众多，行业市场化程度较高，竞争较为激烈。尽管公司在精密零部件细分领域具有一定的技术、设备、客户、人才等优势，但下游产品技术迭代快，同行业竞争对手的技术水平也不断随之发展，如果公司在激烈的市场竞争中不能有效整合资源、及时开发新品、响应客户需求、提高产品质量，或者公司不能在现有产品领域及新应用领域进行有效的市场开拓，将面临市场份额下降及盈利能力下滑的风险。

（三）技术人才流失及核心技术泄密的风险

作为精密电子零部件行业的高新技术企业，高素质的人才对公司未来的发展举足轻重。基于技术团队在精密电子零部件领域突出的研发创新能力，公司逐步建立起业内竞争优势。虽然正常的人才流动不会对公司的研发和经营造成重大不利影响，且公司与主要技术人员签署了竞业禁止协议，但如果主要技术人员大量流失，则可能对公司的研发和生产活动产生不利影响，进而影响公司经营业绩。

（四）偿债压力和流动性风险

报告期内，公司资产负债率分别为 81.50%、87.03%、92.33%和 89.20%，流动比率分别为 0.68、0.51、0.41 和 0.41，速动比率分别为 0.55、0.39、0.27 和 0.29，资产负债率较高，长短期偿债能力较弱且持续下降。报告期内，公司归母净利润分别为-12,613.89 万元、-12,394.93 万元、-19,006.26 万元和-9,126.49 万元，在报告期前三年亏损持续扩大。截至 2026 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 3.35 亿元，一年以内到期的长期借款余额为 0.71 亿元，长期借款余额为

4.31 亿元。如果公司未来的经营业绩和经营活动现金流量出现不利变化，或者与相关金融机构的合作关系出现不利变化，可能导致公司面临较大的偿债压力和流动性风险，进而影响公司持续经营能力。

（五）即期收益被摊薄的风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果公司业绩暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成后公司的即期回报（每股收益等财务指标）将存在被摊薄的风险。

（六）募投项目实施的风险

本次发行募集资金将用于“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”“补充流动资金及偿还银行贷款项目”。公司已就本次募集资金投资项目进行了详细市场调研与严格的可行性论证，本次募投项目建设是基于客户需求、市场前景、经营战略等做出的审慎决策。在募投项目实施过程中，公司将严格按照预定计划推进项目落地，但若因宏观环境、经济政策变化等不可预见的因素导致开发进度、投资成本等方面出现不利变化，将可能导致募投项目建设周期延长或项目实施效果低于预期，进而对公司经营产生不利影响。

（七）募投项目效益未达预期的风险

本次募集资金投资项目的实施进度和实施效果存在一定的不确定性。虽然本次募投项目与公司现有主营业务密切相关，公司对募集资金投资项目经过认真的可行性分析及论证，并在人员、技术、市场等方面进行了充分的准备，但是在项目实施过程中，仍可能存在因项目进度、投资成本和市场需求发生变化等原因造成的效益未达预期的风险。

（八）募投项目新增资产折旧摊销影响公司业绩的风险

本次募投项目中包含较大规模的资本性支出，项目建成后，相应折旧摊销费用将显著增加。考虑到募投项目从建设到全面达产以及市场消化新增产能需要一定周期，在项目效益尚未充分释放的阶段，新增折旧摊销将在一定程度上影响公司短期盈利水平。若未来市场环境发生不利变化，导致募投项目实际效

益低于预期，则新增折旧摊销将对公司未来经营业绩造成不利影响。

（九）股票价格波动风险

公司股票在上交所科创板上市，公司股票价格除受公司经营状况、财务状况等基本面因素影响外，还会受到政治、宏观经济形势、经济政策或法律变化、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期以及其他不可预测因素的影响。

（十）审批风险

本次向特定对象发行股票尚需取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。该等审批事项的结果存在不确定性。

目录

公司声明 1

重大事项提示 2

一、本次向特定对象发行股票情况 2

二、重大风险提示 5

目录 9

释义 12

一、一般释义 12

二、专业释义 13

第一章 发行人基本情况 16

一、发行人基本信息 16

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 16

三、发行人所处行业情况 18

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 36

五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 44

六、现有业务发展安排及未来发展战略 44

七、财务性投资情况 49

八、同业竞争情况 51

九、关于违法行为、资本市场失信惩戒相关信息 52

第二章 本次证券发行概要 53

一、本次发行的背景和目的 53

二、发行对象及其与公司的关系 55

三、本次向特定对象发行股票方案概要 55

四、募集资金投向 59

五、本次发行是否构成关联交易 60

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 60

七、本次发行是否会导致公司股权分布不具备上市条件 60

八、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模” 60

九、本次发行符合《管理办法》第十一条规定的情形 62

十、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序.....62
第三章 董事会关于本次募集资金的可行性分析 64
一、本次向特定对象发行的募集资金使用计划.....64
二、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系.....65
三、本次募集资金投资项目实施的必要性及可行性.....65
四、本次募集资金投资项目的具体情况.....70
五、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.....77
六、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....78
七、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”的情况.....78
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 80
一、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划.....80
二、本次发行完成后上市公司科研创新能力的变化.....80
三、本次发行完成后上市公司控制权结构的变化.....80
四、本次发行完成后上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....80
五、本次发行完成后上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....81
六、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化.....81
第五章 历次募集资金的使用情况 82
一、最近五年内募集资金运用的基本情况.....82
二、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用.....90
三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论.....91
第六章 与本次发行相关的风险因素 92
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素.....92
二、本次发行相关风险.....97
第七章 与本次发行相关的声明 99
一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明.....99
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....100

三、保荐人（主承销商）声明.....101
保荐人（主承销商）总经理声明.....102
保荐人（主承销商）董事长声明.....103
四、发行人律师声明.....104
五、会计师事务所声明.....105
董事会声明.....106
一、关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明.....106
二、关于填补本次发行摊薄即期回报的具体措施和承诺.....106
三、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺.....107

释义

在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般释义

昀冢科技、公司、本公司、发行人	指	苏州昀冢电子科技股份有限公司
昀冢有限/有限公司	指	苏州昀冢电子科技有限公司，公司之前身，于 2019 年 12 月整体变更为苏州昀冢电子科技股份有限公司
苏州昀一	指	苏州昀一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
苏州昀二	指	苏州昀二企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
苏州昀三	指	苏州昀三企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
苏州昀四	指	苏州昀四企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
苏州昀五	指	苏州昀五企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（后更名为徐州市策屹企业管理合伙企业（有限合伙））
苏州昀六	指	苏州昀六企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（后更名为徐州源滕企业管理合伙企业（有限合伙），已注销）
天蝉智造	指	苏州天蝉智造股权投资合伙企业（有限合伙）
伊犁苏新	指	伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）
南京道丰	指	南京道丰投资管理中心（普通合伙）
苏州昀钐	指	苏州昀钐精密冲压有限公司
苏州昀石	指	苏州昀石精密模具有限公司
苏州昀灏	指	苏州昀灏精密模具有限公司
安徽昀水	指	安徽昀水表面科技有限公司
池州昀冢	指	池州昀冢电子科技有限公司
池州昀海	指	池州昀海陶电科技有限公司（曾用名：池州昀海表面处理科技有限公司）
宣城昀海	指	宣城昀海电陶科技有限公司
上海吉塚	指	上海吉塚电子有限公司
凯谋电子	指	深圳市凯谋电子科技有限公司
股东（大）会	指	苏州昀冢电子科技股份有限公司股东（大）会
董事会	指	苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会（已取消）
三会	指	公司股东（大）会、董事会及监事会
公司章程	指	《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会

上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《审核规则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
保荐人、主承销商、国投证券	指	国投证券股份有限公司
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元，人民币万元，中华人民共和国法定货币单位
报告期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月
本募集说明书	指	《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》

二、专业释义

3C 产品/行业	指	计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三者结合，亦称“信息家电”产品/行业
CCM	指	CMOS Camera Module 互补金属氧化物半导体摄像模组的英文缩写，是用于各种便携式摄像设备的核心器件，与传统摄像系统相比具有小型化、低功耗、低成本、高影像品质的优点
VCM	指	Voice Coil Motor 音圈电机的英文缩写，是一种特殊形式的直接驱动电机，具有结构简单、体积小、高加速、响应快等特性
SL 件	指	纯塑料件产品
IM 件	指	Insertmolding 模内注塑的缩写，代指金属插入成型产品
IC 芯片	指	Integrated Circuit Chip 是将大量的微电子元器件（晶体管、电阻、电容等）形成的集成电路放在一块塑基上，做成一块芯片，包含晶圆芯片和封装芯片
CMI	指	Chip Molding Integration 芯片插入集成，是一种采用冲压-注塑-SMT 相结合的方式，在成形基座上镶嵌入复杂的电子线路，将 IC 用 SMT 工艺直接贴合到基座上，并进行封装的生产工艺
IV-HD CMI	指	IV-High-Density Chip Molding Integration，指公司第四代高密度互连 CMI 产品
YOKE	指	音圈马达用固定金属外壳，用来保护马达的整体结构
DPC、DPC 陶瓷基板	指	直接镀铜陶瓷基板
T/R	指	发送/接收
LED	指	发光二极管
MLCC	指	片式多层陶瓷电容器

OIS	指	Optical Image Stabilization 光学防抖的缩写，光学防抖是指依靠特殊的镜头或者 CCD 感光元件的结构在最大程度上降低操作者在使用过程中由于抖动造成的影像不稳定
FEMA	指	Failure Mode and Effect Analysis 失效模式与影响分析即“潜在失效模式及后果分析”的简称，分析产品故障原因等，包括设计、制造过程、使用、承包商/供应商以及服务等
AOI	指	Automated Optical Inspection 自动光学检测的缩写，是基于光学原理在生产过程中对产品尺寸、形状、缺陷、位置度进行检测的设备
SMT	指	Surface Mounted Technology 表面组装/贴装技术的英文缩写，是电子组装行业里最流行的一种技术和工艺；它是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印刷电路板的表面或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术
ONE BOX	指	车身稳定系统与刹车助力器的整体化方案
DNV•GLISO9001/IATF16949 认证	指	国际权威认证机构-挪威船级社（DNV）颁布的质量管理体系认证证书
日本三美	指	三美电机株式会社（MITSUMI ELECTRIC CO., LTD.）
阿尔卑斯	指	阿尔卑斯电气株式会社（ALPS ELECTRIC CO., LTD.）
西可集团	指	厦门市众惠微电子有限公司、昆山丘钛微电子科技股份有限公司、河源友华微机电科技有限公司、昆山丘钛智行致远科技有限公司、Actutek Philippines Corporation 和艾特电科技股份有限公司
舜宇集团、舜宇光学	指	宁波舜宇光电信息有限公司、信阳舜宇光学有限公司余姚分公司、余姚舜宇智能光学技术有限公司、浙江舜宇光学有限公司和浙江舜宇智领技术有限公司
新思考、新思考集团	指	新思考电机股份有限公司（原名：新思考电机有限公司）、新思考电机（合肥）有限公司、新思考电机（南昌）有限公司以及受同一实际控制人控制的江西晶浩光学有限公司、江西欧菲光学有限公司、江西欧迈斯微电子有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司和欧菲微电子（南昌）有限公司
TDK、TDK 集团	指	SAE MAGNETICS (H.K.) LTD、TDK PHILIPPINES CORP.、TDK TAIWAN CORP.和东莞长安新科电子制品有限公司
皓泽集团、皓泽电子	指	河南皓泽电子股份有限公司和沁阳市皓泽电子有限公司
京西重工	指	京西重工（上海）有限公司
万向精工	指	浙江万向精工有限公司
中蓝光电	指	辽宁中蓝光电科技有限公司
三井金属	指	三井金属矿业株式会社（MITSUIMINING&SMELTING CO.,LTD.）
捷太格特	指	捷太格特株式会社（JTEKTCORPORATION）
东洋电装	指	上海东洋电装有限公司

拿森汽车	指	拿森智能科技（浙江）股份有限公司（曾用名：上海拿森汽车电子有限公司）和拿森汽车科技（杭州）有限公司

注：本募集说明书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本募集说明书中若出现表格总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一章 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	苏州昀冢电子科技股份有限公司
英文名称	SUZHOU GYZ ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
统一社会信用代码	91320583085045936C
注册资本	12,000.00 万元
股票代码	688260
股票简称	昀冢科技
上市地	上海证券交易所科创板
法定代表人	王宾
有限公司设立时间	2013 年 12 月 4 日
上市时间	2021 年 4 月 6 日
注册地	昆山市周市镇宋家港路 269 号
公司网址	http://www.gyz.com
电子邮箱	IR@gyzet.com
营业期限	2013-12-04 至无固定期限
所属行业	C3989 其他电子元件制造
经营范围	电子产品的研发；塑料制品的生产、销售；电子元器件、电子产品及配件、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、机电设备、五金机电、金属材料的研发、生产制造、销售；精密模具及自动化设备的设计研发、制造、加工及销售；工艺品、生活日用品的销售；电子产品技术咨询；货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止出口的货物及技术除外）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	专业从事消费电子光学、汽车电子、电子陶瓷等领域精密电子零部件产品的研发、设计、生产和销售

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）发行人股本结构

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人股本结构如下：

股份类别	持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件流通股份	**-**	**-**
二、无限售条件股份	**120,000,000**	**100.00%**
其中：人民币普通股	120,000,000	100.00%

股份类别	持股数量（股）	持股比例
三、股份总数	**120,000,000**	**100.00%**

（二）前十名股东持股情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司股本总额为 120,000,000 股，前十名股东持股数量、股份性质如下表：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份数量（股）
1	苏州昀三	其他	10,064,830	8.39	-
2	王宾	境内自然人	10,023,220	8.35	-
3	苏州昀二	其他	9,911,830	8.26	-
4	苏州昀四	其他	9,556,490	7.96	-
5	苏州昀一	其他	7,865,650	6.55	-
6	李倩	境内自然人	2,290,123	1.91	-
7	中国工商银行股份有限公司－财通集成电路产业股票型证券投资基金	其他	2,145,261	1.79	-
8	中国工商银行股份有限公司－财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	2,006,023	1.67	-
9	J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	其他	1,806,844	1.51	-
10	徐州市策屹企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1,701,090	1.42	-
合计			**57,371,361**	**47.81**	**-**

（三）控股股东和实际控制人基本情况

截至本募集说明书签署日，公司股东王宾持有公司 10,023,220 股股份，占公司总股本的 8.35%，并通过苏州昀二控制公司 8.26%的股份，通过苏州昀三控制公司 8.39%的股份，通过苏州昀四控制公司 7.96%的股份，通过苏州昀一控制公司 6.55%的股份。因此，王宾直接及间接控制公司合计 39.52%的股份，为公司的控股股东和实际控制人。

王宾，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号码为 34100219780207****，住所为上海市松江区九亭镇沪亭北路**弄**号**室。1995 年 9 月至 1997 年 9 月，担任黄山华康制药有限公司设备科技术人员；1997 年 10 月至 2001 年 8 月，担任上海永新彩色显像管有限公司产线技术人员；

2001 年 9 月至 2003 年 7 月，获得上海外国语大学日语专业专科毕业证书；2003 年 11 月至 2004 年 8 月，担任日本 IHI 株式会社上海代表处翻译；2004 年 11 月至 2012 年 9 月，担任日本大冢化学株式会社上海事务所副所长；2012 年 9 月至 2013 年 7 月，担任上海吉塚行政总监；2013 年 7 月至 2019 年 12 月，担任上海吉塚监事；2013 年 12 月至 2018 年 12 月，担任公司执行董事、总经理、技术开发本部本部长和市场销售本部本部长；2016 年 3 月至 6 月、2017 年 4 月至 2019 年 9 月，担任深圳市昀城材料有限公司总经理；2016 年 3 月至 2021 年 7 月，担任香港昀塚电子科技有限公司董事；2017 年 6 月至今，历任苏州昀钐精密冲压有限公司监事、执行董事兼总经理、董事；2018 年 9 月至今，担任苏州昀一、苏州昀二、苏州昀三、苏州昀四执行事务合伙人；2020 年 3 月至今，担任苏州昀灏精密模具有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至今，担任池州昀冢电子科技有限公司董事兼总经理；2021 年 1 月至今，担任池州昀海陶电科技有限公司监事； 2024 年 11 月至今，担任池州昀鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 11 月至今，担任池州昀腾企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 12 月至今，担任公司董事长、总经理。

截至本募集说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人所持发行人股份不存在质押、被司法机关冻结、限售的情形，亦不存在其他争议情况。

三、发行人所处行业情况

（一）公司的主营业务及所处行业

公司是一家专业从事消费电子光学、汽车电子、电子陶瓷等领域精密电子零部件产品研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业。

公司通过自主创新，以产品自主工艺设计、模具自主开发和精密加工为支撑，依托冲压、电镀、注塑、SMT、芯片封装测试、组装等先进工艺及配套的自动化装备研制能力和产品创新能力，为客户提供精密电子零部件产品和集成方案的一体化制造。自成立以来，公司即专注于消费电子光学领域，该业务一直为公司的支柱业务之一。近年来凭借着在消费电子领域不断积累的竞争优势，公司将业务逐渐延伸至汽车电子、电子陶瓷等领域。

在消费电子光学领域，公司主要产品包括芯片插入集成件（CMI 件）、纯塑料件（SL 件）、金属插入成型件（IM 件）等，主要应用在智能手机摄像头中的音圈马达 VCM 和摄像头模组 CCM 中。其中，CMI 系公司经过多年持续研发，于 2017 年在行业内首次推出的独家产品，并平均每两年推出 CMI 迭代升级产品，产品集成度不断提高，功能更加丰富，目前已至第四代，在该细分领域的产品竞争力和市占率持续保持行业领先地位。在该领域公司已成功与新思考、西可集团、TDK、舜宇光学等产业链核心环节的头部企业建立长期深度合作关系，产品广泛应用于华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、传音等国内主流手机品牌，并通过大疆、影石创新、Meta 等终端客户积极开拓无人机、AI、可穿戴设备等新的应用场景。

在汽车电子领域，公司相关产品包括 SL 件和 IM 件等，主要涉及底盘线控制动系统、转向系统以及电子门窗系统等，其中，重点布局的线控底盘制动系统领域主要包括 ABS、ESC、ONE BOX 等产品。公司已通过京西重工、万向精工、捷太格特、三井金属、拿森汽车、东洋电装、比亚迪等汽车领域客户认证，伴随国内外新能源汽车市场规模持续增长、技术不断突破、产业链日益完善，该业务规模有望持续扩大。

在电子陶瓷领域，公司业务主要包括直接镀铜陶瓷基板（DPC）和片式多层陶瓷电容（MLCC）两大部分。MLCC 作为全球用量最大、发展最快的片式电子元器件之一，市场规模庞大。 伴随 AI 服务器、汽车电子等领域的快速发展，其市场规模呈现稳步增长态势。MLCC 业务作为公司中长期战略性布局的业务之一，公司为此投入了大量资源，聚焦于“高容值、高可靠性”产品的研发，目前产品已经覆盖 0201、0402、0603、0805、1206 等系列尺寸规格，细分产品规格可达数百种，并在实现关键材料自主可控、核心装备自主研发制造等方面取得了一定的研发成果，逐渐构建起“材料-设备-工艺”的全流程协同创新机制，为后续高质量发展打下了坚实的基础。

在 DPC 业务方面，伴随着工业激光设备及 T/R 管壳国产化趋势，公司积极跟进陶瓷热沉及 T/R 管壳产品需求，致力于推动相关产品国产化进程。公司自主开发了预制金锡陶瓷热沉产品，包括预制金锡的氮化铝、碳化硅、T/R 管壳等产品，该类产品具有高耐热、高绝缘性、高导热率等特点，被广泛应用于高

功率激光器、激光切割、激光焊接、航天卫星等领域。在中国半导体行业发展的日渐成熟的背景下，陶瓷热沉也将在更多新兴的细分市场和赛道上得到广泛的应用。未来公司将通过持续的技术创新、产品迭代升级，致力于将陶瓷热沉打造成为行业标杆。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019 年修订），公司的主营业务属于“C 制造业”大类下“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中“C3989 其他电子元件制造”，细分行业为精密电子零部件制造业，属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的鼓励类产业。根据国家统计局发布的《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”，符合战略新兴产业的发展方向。

（二）所处行业的主要特点

1、公司所处行业主管部门及监管体制

国家发展和改革委员会与工业和信息化部等政府部门对本行业实行行业宏观管理，相关管理职能如下：

主管部门	相关管理职能
国家发展和改革委员会	国家发展和改革委员会作为行业主要宏观管理部门，其相关职能为：负责拟订行业规划、产业政策和行业技术规范和标准并组织实施，提出优化产业布局和结构的政策建议；监测工业行业日常运行；指导行业技术进步和科技创新等。制定综合性产业政策，推进产业结构化调整；组织拟订产业技术进步的战略，规划和方针。
工业和信息化部	中华人民共和国工业和信息化部作为电子信息行业的行政主管及行业监管部门，其主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准。

公司主要为客户提供精密电子零部件，因此中国电子元件行业协会是本行业的主要自律性组织。除此之外，公司还会自主设计、开发精密模具，以满足不同精度产品的需要，因此中国模具工业协会也对公司的相关业务进行管理。自律管理职能如下：

行业协会	相关自律管理职能
中国电子元件行业协会	在政府部门和企（事）业之间发挥桥梁纽带作用。积极向政府部门反映行业、会员诉求，协助政府部门对电子元件行业进行行业管理；履行好服务企业的宗旨。根据授权进行行业统计；掌握国内外行业发展动态，收集、发布行业信息；依照有关规

行业协会	相关自律管理职能
	定出版报刊、设立网站，开展技术、经济、管理、市场等咨询服务；组织人才、技术、管理、法规等培训工作等。
中国模具工业协会	开展调查研究，根据授权开展行业信息统计，掌握行业现状，研究行业发展方向、战略和政策目标，提出行业发展规划的建议；协助有关部门制定（修订）模具产品的国家（行业）技术标准（规范），制定有关团体标准，积极推进企业的标准化工作，不断提高模具工业的标准化、专业化、信息化、商品化水平等。

2、行业主要监管法律法规及政策

政策名称	发布时间	颁发机构	相关内容
《电子信息制造业 2025－2026 年稳增长行动方案》	2025 年 8 月	工业和信息化部、市场监督管理总局	个人计算机、手机向智能化、高端化迈进；推动手机、个人计算机、家庭网关设备、视听设备、服务器等整机和零部件迭代升级；强化技术和产品形态创新，提振手机、电脑、电视等传统电子产品消费。
《机械工业数字化转型实施方案》	2025 年 7 月	工业和信息化部等八部门	多产品混线生产和快速换线，敏捷响应市场需求。搭建模块化柔性可重构产线，使得产线能够根据订单、工况、库存等变化，实现快速换线和按需配置，满足多品种小批量机械产品快速和低成本生产需求。
《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》	2025 年 1 月	商务部等五部门	明确补贴品种和补贴标准，优化补贴流程，手机、平板、智能手表（手环）生产企业、流通企业开展优惠让利活动。
《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》	2025 年 1 月	国家发改委、财政部	对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等 3 类数码产品（单件销售价格不超过 6000 元），按产品销售价格的 15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴 1 件，每件补贴不超过 500 元。
《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	2024 年 3 月	国务院	围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造。推广应用智能制造设备和软件，加快工业互联网建设和普及应用，培育数字经济赋智赋能新模式。
《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	2024 年 1 月	工业和信息化部等七部门	强调补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺等短板，并围绕装备、原材料、消费品等重点领域，面向设计、生产、检测、运维等环节打造应用试验场，以产品规模化迭代应用促进未来产业技术成熟。

政策名称	发布时间	颁发机构	相关内容
《产业结构调整指导目录（2024年本）》	2023年12月	国家发改委	“新型电子元器件制造”以及“智能硬件和应用电子”被纳入鼓励类。
《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》	2023年9月	工业和信息化部、财政部	依托技术和产品形态创新提振手机等传统电子消费，推动手机品牌高端化升级，培育壮大折叠屏手机产业生态，面向VR/AR重点领域技术攻关。
《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	2023年1月	工业和信息化部等六部门	研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺。
《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》	2022年12月	国务院	更好满足中高端消费品消费需求，促进民族品牌加强同国际标准接轨，充分衔接国内消费需求，增加中高端消费品国内供应。
《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》	2022年9月	国务院	统筹有关政策资源，加大对基础电子产业（电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业）升级及关键技术突破的支持力度。通过实行“揭榜挂帅”等机制，鼓励相关行业科研单位、基础电子企业承担国家重大研发任务。引导建立以行业企业为主体、上下游相关企业积极参与、科研院所有力支撑的研发体系，重点支持发展技术门槛高、应用场景多、市场前景广的前沿技术和产品。
《“十四五”数字经济发展规划》	2022年1月	国务院	着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》	2021年3月	中国人大	补齐基础零部件及元器件、基础工艺和产业技术基础等短板。发展虚拟现实和增强现实产业，发展虚拟现实整机、感知交互等设备和行业解决方案。
《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	2021年1月	工业和信息化部	瞄准智能手机、穿戴式设备、无人机、VR/AR设备、环境监测设备等智能终端市场，推动微型片式阻容元件、微型大电流电感器、微型射频滤波器、微型传感器、微特电机、高端锂电等片式化、微型化、轻型化、柔性化、高性能的电子元器件应用。
《江苏省制造业贷款财政贴息实施方案（2024年）》	2024年3月	江苏省工业和信息化厅、财政厅	支持企业实施智能化改造、数字化转型；支持企业购置软硬件设备，包括但不限于高档数控机床、智能化自动化生产线成套设备、传感器、检验检测设备等。对符合要求的企业进行补助。
《安徽省“十四五”电子信息制造业发展规划》	2022年3月	安徽省人民政府	基础产业提升重点核心基础元器件。电路类元器件：重点发展微型化、片式化阻容感元件，高频率、高精度频率元器

政策名称	发布时间	颁发机构	相关内容
			件，耐高温、耐高压、低损耗、高可靠半导体分立器件及模块，小型化、高可靠、高灵敏度电子防护器件等。
《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》	2021 年 8 月	江苏省人民政府	全力打造先进制造业集群，重点发展集成电路，推动先进封装工艺升级和产业链协同创新；提升高端封装材料自主化能力；培育智能终端产业集群，支持智能手机、AR/VR 设备等终端核心器件研发，推动微型化、高可靠性传感器应用。
《苏州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》	2024 年 5 月	苏州市人民政府	聚焦重点行业推动设备更新和技术改造，推广应用智能制造设备。

3、行业概况

公司自成立以来，持续聚焦手机光学领域精密电子零部件的设计、制造和集成方案，经过长期的业务发展与行业拓展，目前业务主要覆盖消费电子、汽车电子和电子陶瓷三大领域。

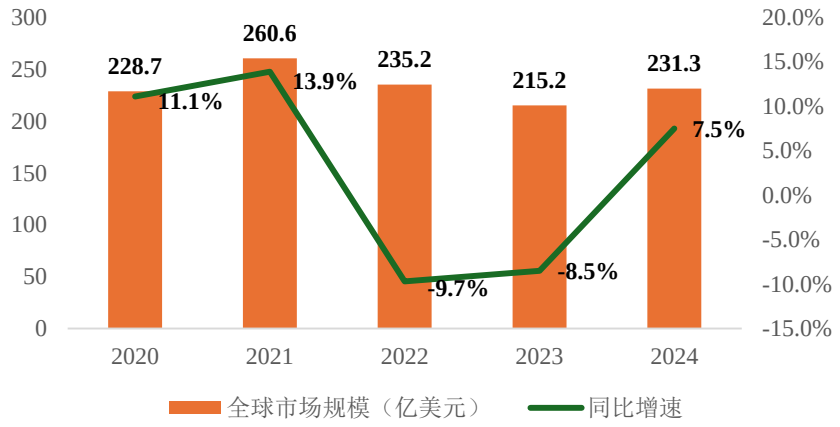
（1）电子陶瓷行业

在电子陶瓷领域，公司布局 MLCC 和 DPC 陶瓷基板两大业务。

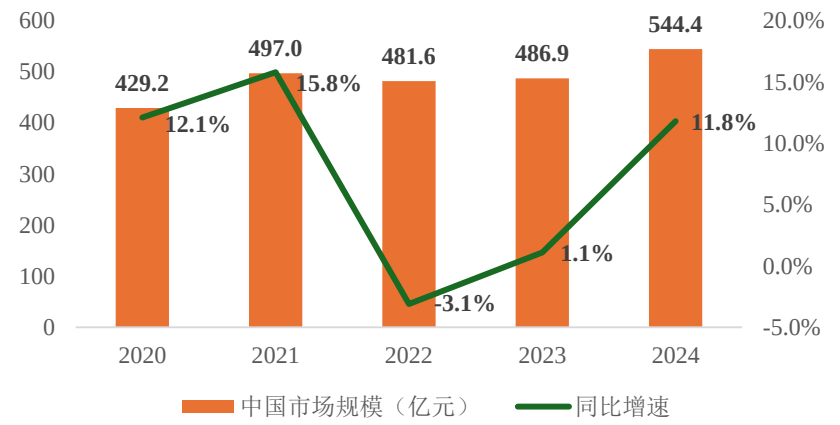
MLCC 被称为“电子工业大米”，是陶瓷电容的一种，具有温度范围宽、电容范围宽、介质损耗小、体积小、价格低等特点，被广泛应用于移动终端、高端装备、汽车、计算机、通信、家电等多个重要领域，占据陶瓷电容超过 90%的市场份额。

随着全球整体经济恢复增长，手机、笔记本电脑在内的消费电子产品订单需求开始回升，叠加通信设备、汽车电子、工业控制等领域市场需求增加，全球 MLCC 市场重回增长态势，呈现量价齐升状态。根据赛迪顾问数据，2024 年全球 MLCC 市场规模达到 231.3 亿美元，同比增长 7.5%，穿越市场周期低谷。其中我国 MLCC 市场在庞大的需求下，也实现触底反弹，市场规模达 544.4 亿元，同比增长 11.8%，相比全球增速高 4.3 个百分点。

2020-2024 年全球 MLCC 市场规模及增速



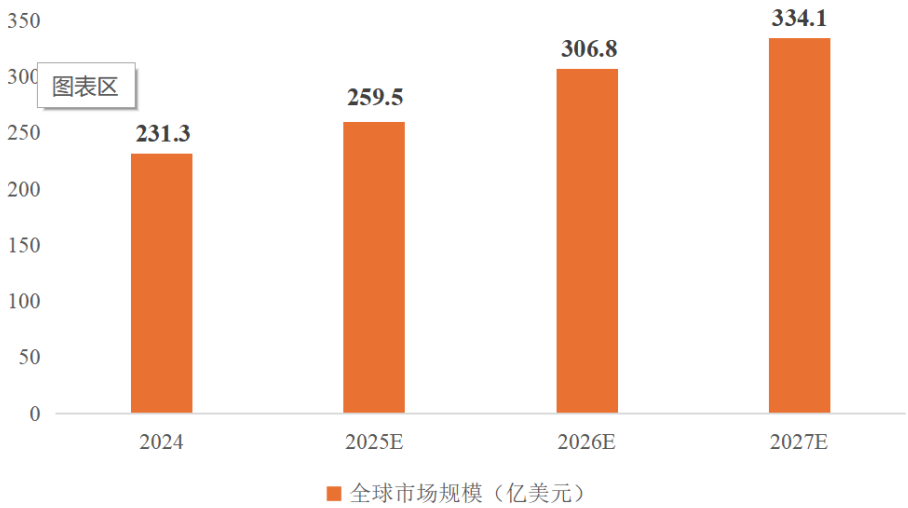
2020-2024 年中国 MLCC 市场规模及增速



数据来源：赛迪顾问

随着 5G 通信、汽车电子、人工智能等领域的技术突破与市场扩张，全球 MLCC 市场需求将迎来爆发式增长，预计从 2024 年的 231.3 亿美元增长到 2027 年的 334.1 亿美元，年复合增长率达 13.0%。

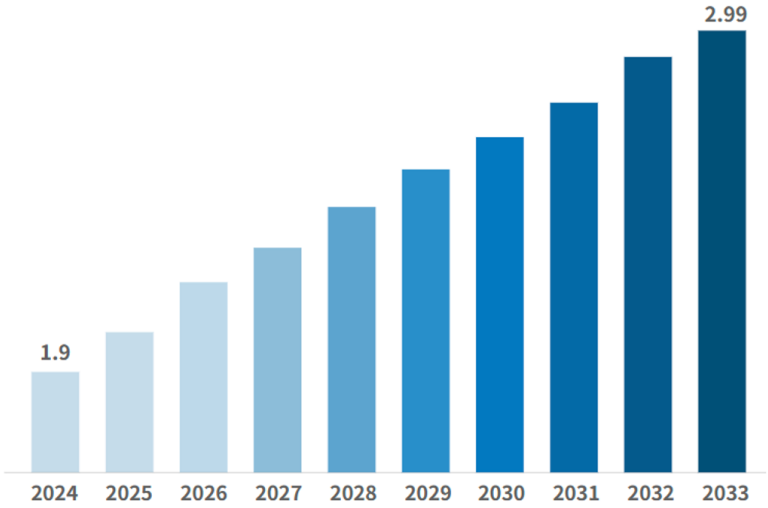
2024-2027 年全球 MLCC 市场规模预测



数据来源：赛迪顾问

DPC（直接电镀铜技术）属于陶瓷基板表面金属化工艺的一种，其他常见表面金属化工艺还包括 HTCC/LTCC（包括高温/低温共烧陶瓷技术）、DBC（直接键合铜技术）、AMB（活性金属焊接技术）、TFC（薄膜技术）等。根据 Maximize Market Research 统计，2021 年全球陶瓷基板市场规模达到 65.9 亿美元，预计至 2029 年全球市场规模将达到 109.6 亿美元，CAGR 为 6.57%。根据 Business Research Insights 数据，2024 年全球 DPC 陶瓷基板市场规模已达 19 亿美元，预计 2033 年将进一步增长至 29.9 亿美元，展现出强劲发展潜力。陶瓷基板领域目前仍主要被日本京瓷株式会社、日本东芝材料株式会社等企业占据，国产替代空间大。

2024-2033 年全球 DPC 陶瓷基板市场规模（十亿美元）



数据来源：Business Research Insights

（2）消费电子行业

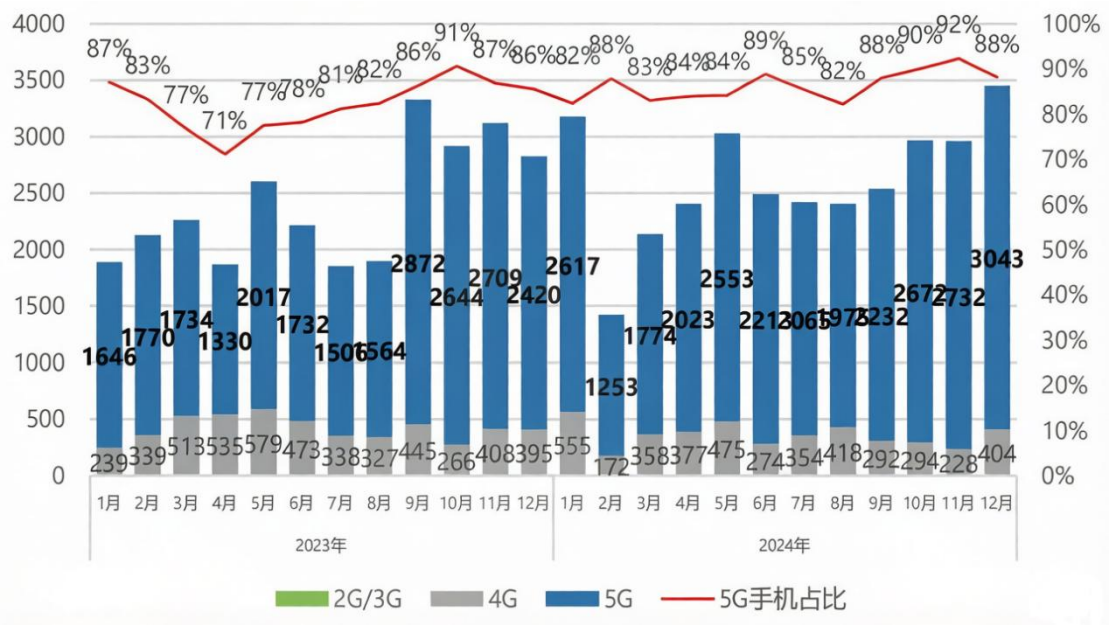
近年来，随着我国电子信息产业的快速发展，尤其是移动通信、计算机、消费电子、汽车等行业对高端精密电子产品需求的急速增长。公司所在的摄像头光学模组 CCM 及音圈马达 VCM 产业链逐渐从日韩厂商转向国产化发展，光学马达零部件市场逐渐趋于成熟，从而出现了一批以精密模具制作、精密加工为核心竞争力，在材料性能改善、研发、生产工艺、销售、品牌方面均逐渐脱颖而出的优秀企业。

公司的产品目前主要应用于手机摄像头光学模组 CCM 和音圈马达 VCM 中，终端覆盖国内主流品牌智能手机。全球市场上，国际数据公司（IDC）发布的最新《全球季度手机跟踪报告》初步数据显示，2024 年第四季度（4Q24）全球

智能手机出货量同比增长 2.4%，达到 3.317 亿部，连续第六个季度保持增长。2024 年全年同比增长 6.4%，出货量达到 12.4 亿部，全球智能手机市场出现了强劲复苏。

中国市场上，据 CAICT 中国信通院披露的数据，2024 年 1-12 月，国内市场手机出货量 3.14 亿部，同比增长 8.7%，其中，5G 手机 2.72 亿部，同比增长 13.4%，占同期手机出货量的 86.4%。智能手机方面，2024 年 1-12 月出货量达 2.94 亿部，同比增长 6.5%，占同期手机出货量的 93.7%。

国内手机市场出货量（万部）及 5G 手机占比



数据来源：中国信通院

受益于智能手机终端市场需求复苏，公司营业收入整体保持增长态势。未来伴随智能手机光学摄像头的升级迭代，潜望式摄像头、可变式光圈及光学防抖马达的市场需求有望持续提升，有望带动公司消费电子业务持续增长。

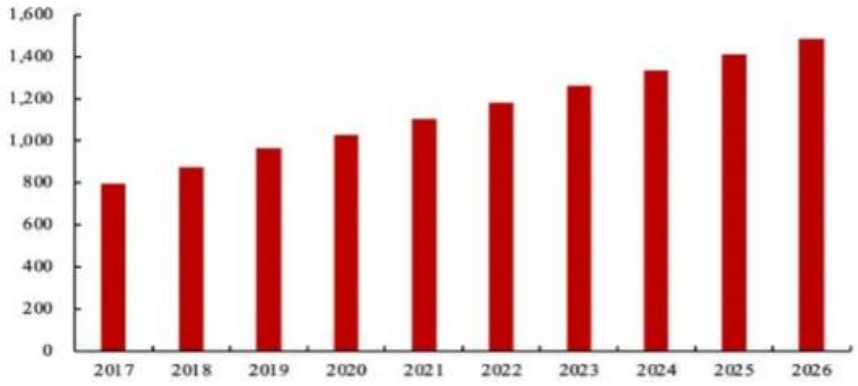
（3）汽车电子行业

在政策推动、需求升级以及技术变革等因素的共同驱动下，电动化、智能化及网联化成为我国汽车产业发展的战略方向。作为汽车产业链的重要组成部分，汽车电子在汽车产业变革中具有引领性作用，根据中投顾问产业研究中心数据，汽车电子占汽车成本比例将由 2020 年的 34.32%提高至 2030 年的 50.00%。

随着汽车市场平稳发展、汽车电子占汽车成本比例提升，汽车电子市场规模持续扩大。根据前瞻产业研究院数据，2017 年我国汽车电子市场规模为 795

亿美元，2023 年已达到 1,261 亿美元，年均复合增长率为 7.99%，预计 2026 年中国汽车电子市场规模有望达到 1,486 亿美元，迈入万亿元人民币市场规模。

2017-2026 年中国汽车电子市场规模（亿美元）



数据来源：前瞻产业研究院

（三）行业竞争情况

1、行业竞争格局及主要竞争对手

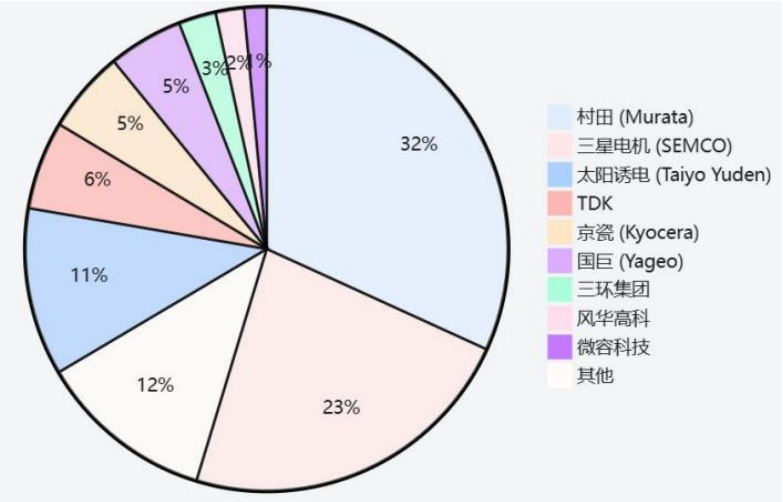
消费电子系公司长期以来的支柱业务。而随着新业务 MLCC 及 DPC 陆续实现大规模量产，公司电子陶瓷业务收入及占比快速提升。

（1）电子陶瓷

①行业竞争格局与公司地位

MLCC 领域，从全球竞争格局来看，第一梯队系以村田（Murata）、三星电机（SEMCO）为代表的日韩巨头，有着技术与市场的绝对领先。第二梯队包括日本的太阳诱电（TaiyoYuden）、TDK，以及中国台湾的国巨（Yageo）等。这些厂商在特定领域（如车规、高容）具备较强技术壁垒，是中高端市场重要参与者。第三梯队以中国内地的三环集团、风华高科、微容科技等公司为代表，目前主要占据中低端市场，并正积极向高端领域渗透，是国产替代的主力军。

2024 年 MLCC 全球市场份额（按照营收金额口径）



数据来源：各公司官方业绩会，Gartner，国信证券经济研究所

对于陶瓷基板市场，目前主要被日本京瓷、东芝材料等日本企业占据，部分细分领域日本企业占全球产量可达 60%，公司所处 DPC 陶瓷基板领域主要厂商包括日本京瓷、日本丸和、中国台湾同欣电子等。从 2024 年开始，公司 DPC 陶瓷基板相关产品营收实现快速放量，凭借产品性能优势，已成功切入行业头部企业供应链，成为行业陶瓷热沉产品的主要供应商之一。

陶瓷基板主要竞争企业

数据来源：清枫资本《陶瓷基板行业研究报告》、中泰证券研究所

②行业主要企业情况

1）日本村田（TSE.6981）

日本村田制作所（Murata）是全球领先的电子元器件制造商，成立于 1944 年 10 月，总部位于日本京都府长冈京市。该公司以陶瓷电容器为核心产品，在陶瓷滤波器、高频元件、传感器等领域占据全球市场主导地位。该公司于 1969 年在日本东京证券交易所上市，同时在美国场外交易市场（OTC）及德国法兰克福证券交易所挂牌。中国是其最大海外市场，并在无锡、深圳等地设有 7 个生产基地。该公司截至 2025 财年末（截至 2026 年 3 月 31 日）总资产 31,990.99 亿日元，净资产 27,178.10 亿日元；2025 财年营业收入 18,308.56 亿日元，净利润 2,337.81 亿日元。

2）韩国三星电机（KRX.009150）

韩国三星电机（SEMCO）是三星集团旗下核心电子零部件子公司，成立于 1973 年 8 月，总部位于韩国水原市，于 1979 年 2 月在韩国证券交易所上市。作为全球领先的电子元件制造商，其业务覆盖消费电子、半导体、通信设备等多个领域，产品广泛应用于智能手机、汽车电子、工业设备等场景。该公司截至 2026 年 6 月 30 日总资产 165,659.74 亿韩元，净资产 105,291.42 亿韩元；2026 年上半年营业收入 66,663.18 亿韩元，净利润 5,809.88 亿韩元。

3）日本京瓷（TSE.6971）

日本京瓷株式会社（Kyocera）成立于 1959 年 4 月，总部位于日本京都府京都市，由稻盛和夫创立，最初以精密陶瓷技术为核心，逐步发展为覆盖半导体、通信设备、汽车电子、办公设备等多元化领域的高科技跨国集团。其核心业务包括精密陶瓷零部件（如半导体封装基板、连接器）、电子元件（陶瓷电容器、晶振）、通信系统及医疗设备等，技术壁垒高且广泛应用于 5G、新能源汽车、工业自动化等前沿领域，已在全球多个交易所上市。该公司截至 2025 财年末（截至 2026 年 3 月 31 日）总资产 46,463.14 亿日元，净资产 33,673.72 亿日元；2025 财年营业收入 20,702.03 亿日元，净利润 1,449.20 亿日元。

4）日本丸和（TSE.5344）

日本丸和株式会社（Maruwa）创立于 1973 年，是一家世界级电子元件和电子陶瓷材料的专业生产厂商，2000 年于日本东证 1 部上市，并在新加坡、伦

敦同时上市。日本丸和以陶瓷技术为核心，将业务分为陶瓷、电子元件/组件、石英玻璃、LED 照明四大板块。在陶瓷板块，通过从材料配方调配，到板材/粉末成型、冲压、烧制，到薄膜金属化、蚀刻等陶瓷基板加工，再到电子元器件/组件制造的一体化生产，为客户提供高度定制化的产品。该公司截至 2025 财年末（截至 2026 年 3 月 31 日）总资产 1,626.91 亿日元，净资产 1,472.62 亿日元；2025 财年营业收入 744.76 亿日元，净利润 181.63 亿日元。

5）风华高科（SZ.000636）

广东风华高新科技股份有限公司成立于 1984 年，该公司总部位于广东省肇庆市，注册资本 11.57 亿元，1996 年在深圳证券交易所挂牌上市，是专业从事高端新型元器件、电子材料及电子专用设备研发生产的高新技术企业，核心产品包括片式多层陶瓷电容器（MLCC）、片式电阻器、电感器等，广泛应用于通信、消费电子、汽车电子、工控等领域。**该公司截至 2026 年 6 月 30 日总资产 171.19 亿元，净资产 128.00 亿元；2026 年上半年营业收入 35.00 亿元，净利润 2.92 亿元。**

6）三环集团（SZ.300408）

潮州三环（集团）股份有限公司成立于 1970 年，2014 年在深圳证券交易所创业板上市，总部位于广东省潮州市，在广东潮州、深圳、成都、苏州及德国、泰国等地设有研发中心和生产基地。该公司专注于电子元件及先进材料的研发与生产，核心产品包括多层片式陶瓷电容器（MLCC）、光纤陶瓷插芯、陶瓷封装基座（PKG）、氧化铝陶瓷基板等，覆盖消费电子、通信设备、汽车电子、新能源等领域。**该公司截至 2026 年 6 月 30 日总资产 284.38 亿元，净资产 226.49 亿元；2026 年上半年营业收入 64.23 亿元，净利润 19.32 亿元。**

7）微容科技（A26084，创业板在审企业）

广东微容电子科技股份有限公司成立于 2017 年 9 月，总部位于广东省罗定市，截至 2026 年 4 月创业板 IPO 已获深交所受理。该公司主营业务为微型化、高容量、高可靠等高端 MLCC 的研发、生产与销售，构建了消费类、工业类（含 AI 服务器）、车载类三大核心产品体系，客户涵盖小米、OPPO、中兴通讯、摩尔线程、比亚迪等头部厂商。**该公司截至 2026 年 6 月 30 日总资产**

63.56 亿元，净资产 47.89 亿元；2026 年上半年营业收入 10.09 亿元，净利润 1.20 亿元。

（2）消费电子

①行业竞争格局与公司地位

公司是国内 3C 领域精密零部件提供商，其产品主要应用在智能手机摄像头中的音圈马达 VCM 和摄像头模组 CCM 中，公司直接客户主要为各大 VCM 马达厂商和 CCM 模组厂商。近年来，摄像头光学模组 CCM 及 VCM 产业链逐渐从日韩厂商向国产化发展，例如新思考、皓泽电子、立讯精密等市场份额逐渐超越 TDK、日本三美、阿尔卑斯等外资企业。

公司聚焦智能手机光学及摄像头模组领域，随着终端消费者对智能手机摄像功能、产品品质和个性化设计愈加关注，对智能手机的设计和技术开发能力提出更高要求。与此同时，智能手机的拍摄功能不断创新提升，不同类型的多摄方案组合日益成熟，极大地满足了多样化的市场需求，并且更具轻薄及个性化功能的产品逐渐受到消费者的青睐。随着光学摄像头单机数量的增加，极大地提高了 VCM 和 CCM 的市场应用，为公司的精密电子零部件提供了更广阔的市场。此外，智能手机光学摄像头和模组的市场空间快速提升，潜望式马达及可变式光圈应用逐渐扩大，为公司 CMI 系列产品的应用创造了更多的市场空间。根据 TSR 相关数据，预计到 2026 年，全球 VCM 的出货量将增长至 20 亿颗。

在激烈的市场竞争中，公司始终以技术创新提高产品竞争力，引领行业创新发展。公司开发的 CMI 系列产品自 2017 年成功上市并实现量产后得到同业的高度关注和认可，并针对供应商及终端应用的需求，不断从 CMI 产品向 CCMI、HD-CMI 发展，市场先发优势凸显，产品竞争力不断提升。伴随智能手机光学摄像领域的升级，特别是潜望式马达应用的逐渐扩大，对产品的精密度、空间及性能有了更高的要求，CMI 系列产品不仅在设计开发上独具创新，也可有效降低传统摄像头马达的制造成本，节约马达内部设计空间，为智能手机光学领域的迭代升级提供了更优的解决方案。公司持续突破创新，此前平均每两年推出 CMI 迭代升级产品，已从最初的一代 CMI 产品更新升级至第四代产品。四代产品较三代产品而言，无论是技术门槛、性能还是市场价值均有进一步提

升，且四代产品较三代产品集成度更高，同时增加了陶瓷基板工艺以及 Driver IC，开发难度更高、性能更优。

②行业主要企业情况

1）康而富集团（TWSE.4943）

康而富集团（CONCRAFT）创立于 1991 年，总部位于中国台湾，投身精密塑胶注塑成型与金属零件冲压锻造，于 2016 年在中国台湾证券交易所上市，已成为世界著名的电子零部件厂商。公司囊括了大量电子通讯、模具、冲压、镶嵌注塑、自动化设备等专业的人才，产品广泛应用在笔记本电脑、平板电脑、手机、声学模组、光学模组、天线、汽车电子等领域。子公司昆山康龙电子科技有限公司专注于精密冲压模与塑胶模、声学零组件、光学零组件的生产，产品广泛应用于 3C、汽车电子等领域。**该公司截至 2026 年 6 月 30 日总资产 31.83 亿新台币，净资产 1.05 亿新台币；2026 年上半年营业收入 11.14 亿新台币，净利润-2.09 亿新台币。**

2）信华精机

信华精机有限公司成立于 1986 年，是一家由内地、中国香港合资经营的企业，注册资金 1,950 万美元，是全球最大的机芯生产厂家之一。公司主要生产销售车载镜头、非标自动化设备、（锂）电池管理系统等，是华为的主要外协加工厂之一。自成立以来公司致力于精密电子设备加工工艺的完善与改进，从 1993 年开始从事 SMT 技术的 OEM 产品加工，已拥有超过 20 套具有世界先进水平的 SMT 设备。

3）长盈精密（SZ.300115）

深圳市长盈精密技术股份有限公司成立于 2001 年，于 2010 年在深交所创业板上市，是国内领先的精密电子零组件制造商，主要从事手机机构配套件、LED 精密支架、精密模具等的开发、设计、制造和销售。公司拥有精密模具制造、高速精密冲压、精密塑胶成型以及精密连接器自动化生产设备开发所需的全系列引进生产设备和实验测试仪器，并拥有多项自主产品专利。该公司截至 2026 年 6 月 30 日总资产 273.07 亿元，净资产 87.69 亿元；2026 年上半年营业收入 107.29 亿元，净利润 0.29 亿元。

4）贝隆精密（SZ.301567）

贝隆精密科技股份有限公司成立于 2007 年，于 2024 年在深交所创业板上市，是一家专业从事精密注塑、埋入成型、冲压、模具研发的国家级高新技术企业。主营业务为配套于手机摄像头、精密模组、高清监控摄像头、车载摄像头等领域的精密冲压件、黑物注塑件。公司拥有先进的精密模具加工设备、检测设备、万级无尘注塑车间和精密冲压车间，曾多次获得中国模具工业协会颁发的“精模奖”一等奖。该公司截至 2026 年 6 月 30 日总资产 8.90 亿元，净资产 7.27 亿元；2026 年上半年营业收入 1.92 亿元，净利润 0.04 亿元。

5）昌红科技（SZ.300151）

深圳市昌红科技股份有限公司成立于 2001 年，于 2010 年在深交所创业板上市，是一家从事精密注塑模具、精密注塑成型、部件组装的 OA 系列核心精密零部件供应商，为世界各大品牌打印机、复印机厂商提供配套服务，同时也提供精密医疗及汽车模具的开发与制造。该公司截至 2026 年 6 月 30 日总资产 25.12 亿元，净资产 16.10 亿元；2026 年上半年营业收入为 4.60 亿元，净利润为 0.11 亿元。

6）徕木股份（SH.603633）

上海徕木电子股份有限公司成立于 2003 年，于 2016 年在上交所主板上市，是国内领先的专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的民营自主品牌企业。徕木股份以产品和模具研发为核心，以先进的模具开发技术、精密冲压和注塑等制造技术为支撑，为手机、汽车等多领域客户提供内、外部连接器、保护核心组件以免受到电磁干扰的屏蔽罩的设计方案及产品。该公司截至 2026 年 6 月 30 日总资产 39.75 亿元，净资产 17.16 亿元；2026 年上半年营业收入 8.20 亿元，净利润-0.61 亿元。

7）兴瑞科技（SZ.002937）

宁波兴瑞电子科技股份有限公司成立于 2001 年，于 2018 年在深交所中小板上市，是一家采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术、为客户提供连接器、屏蔽罩、散热片、支撑件、外壳、调节器和整流桥等精密电子零部件产品及模具产品的公司。产品主要用于汽车电子、3C、智能终端、OA 设备、家电

等领域。**该公司截至 2026 年 6 月 30 日总资产 25.45 亿元，净资产 19.61 亿元；2026 年上半年营业收入 9.80 亿元，净利润 0.68 亿元。**

2、进入行业的主要壁垒

（1）技术壁垒

产品研发和模具开发是精密电子零部件制造过程中的重要环节，也是体现企业竞争优势与行业地位的最根本因素。一方面，企业与客户需要共同开发、设计和制定产品方案及具体的技术参数，这一过程需要企业与客户在产品设计与开发、模具设计与开发、产品技术指标测试等领域紧密配合，随着下游产品的差异性越来越大，产品的功能越来越复杂，以及产品不断更新换代，客户对供应商产品研发实力的要求也持续提升。另一方面，模具开发是企业进入下游产品制造领域的关键技术之一，也是企业把技术转化成现实生产力的关键环节。精密模具是精密加工、超精密加工技术等先进制造技术的基础工艺装备，模具的技术水平影响了产品的技术水平。普通生产企业缺乏精密模具的设计开发经验以及专业的模具人才，只能采用定制、外购的方式解决精密模具来源问题，无法自制模具，因而无法在竞争中取得领先优势和较高盈利能力。

而公司近年来大力投入的电子陶瓷领域也具备较高的技术壁垒，属于典型的多学科交叉融合领域，涉及材料科学与工程、微电子学、精细化工、机械工程及自动化控制等多个专业方向，相关理论与技术贯穿产品研发至生产制造的全流程。企业必须实现多学科关键技术的协同攻关，才能实现产品的技术突破。并且电子陶瓷领域众多产品制造工序链条长且环节间耦合度高，各节点均需实施精密的过程管控，部分关键工艺参数更有赖于长期生产实践的技术迭代积累。因此，企业在完成技术攻坚的基础上，尚需依托持续的规模化生产经验沉淀，不断优化工艺技术路线，才能实现高良率下的稳定量产，由此形成了显著的技术壁垒。

（2）客户壁垒

由于精密电子零部件生产商的研发能力和产品质量对下游客户产品质量有关键影响，客户选择供应商的流程非常严苛，而供应商与客户一旦形成了稳定的合作关系，一般不会发生改变。

一方面，供应商需要经过严格的认证才能进入客户的供应链。从事精密电子零部件制造需要取得 ISO9001、ISO14001 等多项国际标准体系认证，认证周期长、难度大；此外，下游客户尤其是行业龙头企业对供应商的选择非常谨慎，除了上述体系认证，供应商一般还要通过客户的供应商认证、产品认证后才能成为合格供应商，整个过程往往需要几年时间，耗费大量的人力、物力和时间。另一方面，供应商与客户之间形成联动的开发机制，客户趋向于与熟悉的供应商合作，建立稳定高效的研发合作关系。对于行业新进入者，只有其产品与现有供应商相比具有非常显著的技术、性能或价格优势，才有可能进入其供应商名录，这提高了行业的进入门槛。而且现在产品集成化趋势越来越凸显，客户鼓励供应商进行集成创新来保证产品质量、精度的稳定可控，双方相互依赖程度更高。

（3）资金壁垒

精密电子零部件行业属于资金密集型行业。一方面，企业在新技术的研发和创新、高端设备的购置、培养和稳定各类技术人才等方面需要投入大量资金，尤其电子陶瓷领域厂房与高等级洁净车间建设、高精度生产设备及检测设备购置均需大规模资金投入，研发方面企业为契合下游应用技术演进趋势，则需在材料体系、制备工艺等维度开展长期、系统性的研发投入与试产验证，以维持技术竞争力，该过程同样伴随较大规模的资金投入。另一方面，下游客户的行业集中度较高，往往占据一定的议价优势，其信用周期相对较长，会对上游企业造成一定的流动资金压力。

（4）供应链管理壁垒

为了快速、及时地响应客户需求，企业必须具备良好的供应链整合管理能力。一方面，通过对供应链资源的良好掌控，企业能充分发挥自身产品设计能力，在确定产品设计方案后，能够快速评定产品设计转向生产制造的可行性，同时帮助客户实现产品设计优化，避免后续生产过程中出现产品无法交付的问题。另一方面，电子零部件制造业上游企业多是原材料生产企业、模具制造企业，规模较小，坐落比较零散，这需要企业具备较强的资源整合能力及优秀的供应链管理能力以保障生产的顺利进行。新进入企业由于在供应商资源及管理经验等方面较为欠缺，从而在设计、制造环节中均处于相对不利地位。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）发行人的主要产品情况

公司主要产品包括 MLCC、DPC 陶瓷基板、CMI 件、SL 件、IM 件及其他等。其中，MLCC 和 DPC 为电子陶瓷领域产品，CMI 件主要应用于消费电子领域，SL 件和 IM 件同时应用于消费电子和汽车电子领域。

1、电子陶瓷器件

（1）MLCC（片式多层陶瓷电容器）

MLCC 被喻为“电子工业大米”，是一种采用流延、印刷、叠层、排胶和共烧等精密工艺制成的无源电子元件，在电子电路中起到储能、滤波、旁路、去耦及稳定电压的关键作用。该产品以钛酸钡基陶瓷为介质，镍或铜为内电极，通过数百至上千层交替堆叠实现高容值与小体积，具有等效串联电阻小、阻抗低、额定波纹电流大、高频特性好、无极性等特点。

公司研发的 MLCC 产品拥有体积小、比容大、寿命长、高频使用时损失率低、可靠性高等优点，目前研发量产产品涵盖 0201、0402、0603、0805、1206 等全尺寸 MLCC 料号，细分产品规格可达数百种。

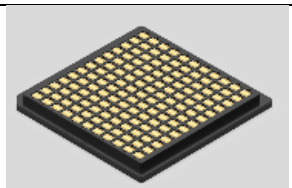
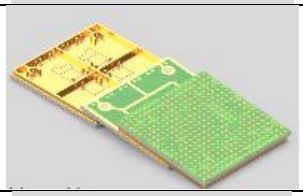
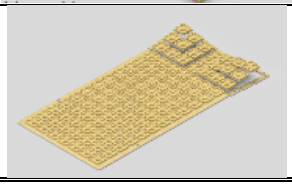
公司研发量产的 MLCC 产品包括 MC 系列、IC 系列和 AC 系列等，分别应用于消费电子、工业控制和汽车电子行业。其中消费电子客户主要集中于移动通信、家用电器和计算机及周边设备等；工业控制领域涵盖工控机、自动化机器人、自动生产线和通讯基站设备等。另外，公司于 2024 年通过 IATF16949 汽车电子质量体系认证，目前所有 AC 系列料号已经全部通过 AEC-Q200 汽车产品认证全项目测试，广泛使用在新能源汽车三电（电池、电机、电控）核心部件、舒适系统、娱乐系统和 ADAS 辅助驾驶系统等。

序号	产品名称	主要应用领域	图例
1	MLCC	手机、音视频设备、PC、汽车和其他工业以及医疗	

（2）DPC 陶瓷基板

DPC 陶瓷基板是一种高性能电子封装基板，采用高导热、高绝缘的陶瓷材料（如氧化铝、氮化铝等）作为载体，通过薄膜工艺在陶瓷表面溅射种子层，再经光刻、电镀等步骤直接形成高精度铜线路。公司的 DPC 陶瓷基板产品目前主要包括陶瓷热沉、T/R 管壳（射频模块管壳）和 LED 陶瓷衬底三类产品。

其中，陶瓷热沉包括氮化铝、氧化铍、碳化硅等产品，主要用于高功率激光器、激光加工、激光焊接等领域，并且在大功率激光陶瓷热沉细分领域，公司在国内市场份额中处于领先地位。T/R 管壳是公司于 2024 年开始量产的新产品，其基于 DPC 陶瓷基板工艺制备的有源相控阵 T/R 组件核心封装载体，通过高精度图形化线路与金属化腔体结构，为射频芯片提供电气互联、物理支撑及散热通路。该产品推动 T/R 组件由传统离散组装向一体化封装变革，凭借垂直互联与收发分区腔体设计，实现了小型化、轻量化及高集成度，显著缩短散热与信号传输路径，在提升信号完整性的同时具备优异的气密性与高可靠性，主要用于 5G 通讯、航天卫星等领域。公司将通过持续的研发投入不断丰富陶瓷基板产品类型，扩大下游应用领域，主要产品示例如下：

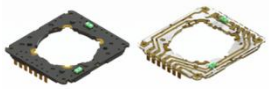
序号	产品名称	主要应用领域	图例
1	陶瓷热沉	高功率激光器、激光加工、激光焊接等功率器件领域	
2	T/R 管壳	5G 通讯微波及射频模块、滤波器、雷达	
3	LED 陶瓷衬底	LED 照明、杀菌消毒、食品加工保鲜、紫外探测与通讯	

2、CMI 件（芯片插入集成件）

公司自主研发生产的 CMI 件顺应消费电子行业轻薄化、模块化、高集成度、绿色环保等趋势，在注塑产品中封装金属端子和电子元器件，将此类产品集成为控制模块，产品具有成型后精度高，尺寸及性能一致性稳定，提高后端组装

良率及减少产品组成物料数量等特点。同时，该方案能够有效规避常规 FPC 组装方案的盲孔开裂、断裂等风险。自 2017 年首次推出该产品以来，此前公司平均每两年完成一次 CMI 迭代升级，目前已推出至第四代 CMI 产品（即 IV-HD CMI），新产品在原有产品基础上增加了陶瓷基板，产品集成度进一步提高，能够有效节省摄像头模组空间，进一步提高了产品技术壁垒，产品竞争力持续保持行业领先地位。目前，该类产品主要应用于消费电子音圈马达 VCM 中，未来将向其他领域进一步渗透。

主要产品示例如下：

序号	产品名称	主要应用领域	图例
1	CMI（一代）	音圈马达 VCM	
	CMI（二代）		
	CMI（三代）		
	CMI（四代）		

3、SL 件（纯塑料件）

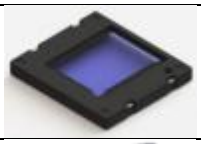
公司生产的 SL 件为纯塑胶成型产品，具体包括支架、镜筒、框架等，主要用于摄像头模组底座、马达载体、潜望式马达、汽车电子零部件等产品。公司建有万级无尘车间，产品具有精度高等特点。报告期内，发行人纯塑料件主要应用于音圈马达 VCM、光学模组 CCM 和汽车电子等领域，主要产品示例如下：

序号	产品名称	主要应用领域	图例
1	支架	光学模组 CCM	
2	镜筒	光学模组 CCM	

序号	产品名称	主要应用领域	图例
3	双摄/多摄模组框架	光学模组 CCM	
4	载体	音圈马达 VCM	
5	双色成型产品	音圈马达 VCM	
6	衬套	汽车电子	
7	齿条挡块	汽车电子	
8	塑料把手	汽车电子	

4、IM 件（金属插入成型件）

公司生产的 IM 件具体包括 IR 红外滤光片组件、双摄/多摄模组框架、基座等，主要是在注塑成型产品中封装金属端子，使此类产品内部具有金属导通线路的功能，同时增加产品强度，减少客户端组装工艺和工时，从而达到降本增效的目的。报告期内，发行人金属插入成型件主要应用于音圈马达 VCM、光学模组 CCM、汽车电子和家电等领域，主要产品示例如下：

序号	产品名称	主要应用领域	图例
1	IR 红外滤光片组件	光学模组 CCM	
2	双摄/多摄模组框架	光学模组 CCM	
3	基座	音圈马达 VCM	

序号	产品名称	主要应用领域	图例
4	门锁系统开关组件	汽车电子	
5	门锁系统开关组件	汽车电子	
6	ABS 组件	汽车电子	
7	EPB 控制组件	汽车电子	
8	电气盖盒	家电	

5、其他

报告期内，公司其他产品主要包含绕线及组装品、电镀加工、金属冲压件、引线框架等，部分产品具体情况如下：

（1）绕线及组装品

绕线及组装品是将直径为 0.04mm 漆包线绕制呈线圈状与塑胶载体组装为一体，达到规定的电阻值及扭力。公司有自动化绕线线体，可实现自动供料包装，直接将漆包线绕制在塑胶载体上，减少组装工站，产品精度一致性稳定。

（2）电镀加工

公司从事的电镀加工业务是指根据客户需求，通过对电镀用药液浓度、pH 值、电阻值、电流值、浴槽温度等参数进行个性化设置，利用电解原理为精密电子零部件铺上金属层，以增加产品的抗腐蚀性、硬度、导电性，还可以防止磨耗及增加表面美观。

（3）金属冲压件

报告期内，公司的金属冲压件主要包括 YOKE、耳机用端子、天线等，主要应用在光学模组 CCM、声学和家电等领域。

（4）引线框架

公司的引线框架产品是封装过程中芯片的载体，可实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，是形成电气回路的关键结构件，产品主要应用于集成电路封装、白色家电等领域。引线框架是原控股子公司池州昀钐的主要业务，池州昀钐 2024 年下半年不再纳入合并报表范围。

（二）主要经营模式

1、研发模式

消费电子业务方面，公司与下游市场保持着紧密的联系，技术团队在经过严谨的市场调查后，会出具《可行性分析报告》，若评审通过，则进入样品设计阶段。设计初期，技术团队会根据指引进行“设计 FMEA”，即失效模式与影响分析，通过对各个零件及构成工序逐一拆解，找出所有潜在的失效模式和相应后果，以便预先采取必要措施防范，从而提高设计的一致性与可靠性。在样品设计完成并通过复核后，技术团队和生产团队根据实践确定工艺流程和实施“工程 FMEA”。在经过打样和流程设计后，即可投入模具生产或设备生产，为产品量产打下坚实基础。

电子陶瓷业务方面，项目启动前，公司经过严谨立项，并评估市场与技术双重可行性。进入设计阶段后，团队首先开展 DFMEA，从粉体配方到多层结构逐一推演潜在风险并制定预防措施。样品设计复核通过后，技术与生产团队共同确定工艺流程，并实施 PFMEA，重点解决流延、叠层、共烧等环节的工艺瓶颈。完成上述分析后，进入打样验证阶段，通过多批次小批量生产验证材料、工艺、设备的全链条稳定性。针对电子陶瓷“料-艺-机”一体化的特点，研发过程需要材料、工艺、设备等多部门协同推进。若样品验证中发现底层科学问题，公司将依托与高校及科研院所的合作平台进行联合攻关，确保产品能够顺利完成从样品到商品的跨越，为后续量产打下坚实基础。

汽车电子业务方面，项目导入阶段，团队基于客户设计图纸开展可制造性评审，识别工艺难点并优化生产方案。样品试制过程中，实施 PFMEA，重点突破精密注塑尺寸稳定性、电磁线圈高张力绕线、SMT 焊接可靠性及控制器总成密封等核心工艺。试制完成后进行全尺寸测量与功能测试，确保样品符合客户工程规范。进入量产阶段，公司推行自动化产线与在线检测技术，实时监控注

塑压力、绕线张力、回流焊炉温及泄漏率等关键参数。生产过程嵌入 100%在线功能测试与老化筛选，确保产品通过客户 PPAP 认可，为线控制动系统提供高可靠性制造支撑。

2、采购模式

（1）采购流程

公司设立资源采购部进行集中采购、资源统一，负责生产所需的原材料、辅料以及生产设备等物资的采购，确立了“以产定购和预计备货”和“以产定购和按需备货”采购模式。公司采用“以产定购”是因为公司主要产品为客户定制品，具备定制化特征，因此，针对销售和生产所需而确定原材料采购量。采用“预计备货”是因为公司的终端用户主要从事消费型行业，产品更新迭代速度较快，为确保能随时响应终端用户的产品需求，及时向供应链下游厂商交货，公司通常会根据客户预测订单量对部分原材料和辅料进行提前采购、合理备货。公司控股子公司池州昀冢确立了“以产定购和按需备货”的采购模式，池州昀冢主要产品为 MLCC，可用于多行业中的电子产品，销售采用“客户+分销”的模式，采用“以产定购和按需备货”的采购模式，可以在确定销售计划后以产定量进行物料、设备采购，从而在保证采购物料满足生产的同时降低物料库存成本。围绕行业主流发展趋势，公司坚持按产品层级实施差异化采购策略，积极推进供应链国产化替代。中低端品类实现全面国产化布局，高端品类有序、分步导入国产方案，降低对日韩供应链的依赖，对冲地缘政治带来的供应风险。同时构建多源化供应体系，减少对单一供应商的集中度依赖，增强供应链韧性，有效应对市场价格及供需波动。

公司具有完善的采购流程控制制度，制定了《采购管理控制程序》，对订购单、供应商选择、供应商评选管理、采购物料验收等方面进行了规定，采购部门从公司的《合格供应商名册》中选择合适的供应商进行订单或相关合同的签署。公司建立了完善的供应商管理机制，并对产品生产、品控、仓储物流等进行实时管控，确保产品品质和及时交付。

（2）供应商管理

公司对于供应商有严格的管控程序：资源采购部首先根据供应商提供的资

料进行初步筛选，发送《供应商基本资料表》和《供方管理体系调查表》给供应商填写基本资料和自我评价，资源采购部根据供应商的生产能力、生产设备、技术以及质量控制能否满足公司产品要求等来确定是否入围；接着，资源采购部要求入围供应商提供样品，由品质部对实物进行检验和测试，必要时先由技术开发本部对样品进行试制、再交由品质部检验和测试，生成《样品鉴定成绩表》；样品通过后，资源采购部、品质部、技术开发本部对供应商进行现场评估，达到标准者被评估为“合格供应商”， 通知不达标者在限定时间内改善。最后，资源采购部和品质部会对合格供应商定期评估和年度稽核，从交期、品质、服务等方面打分，考核结果形成《新供应商能力评估表》，每年都会由品质部制作《供应商年度稽核计划》进行控制。

3、生产模式

公司消费电子、汽车电子以及电子陶瓷 DPC 业务确立了“以销定产”的生产模式，以客户需求为导向，依据销售订单组织和安排生产。生产管理人员接到销售部门的《生产联络单》后，在库存不足的情况下，依据客户订单的交期和当日产能排定《生产计划表》发至车间。对于已达到稳定合作客户的成熟产品，公司会依据市场需求预测来合理备货，从而“储备生产”，满足市场需求。

多层陶瓷电容 MLCC 应用于多个行业，市场需求庞大，公司选择结合市场需求“以产定销”，制定生产计划供销售部门参考销售，并且储备一定的库存量，以应对市场需求。公司采用柔性生产模式，提前锁定市场需求，核心原则为“效率优先、快速切换、批量优化”。

4、销售模式

除 MLCC 业务外，公司主要采用直销的方式为客户提供产品，主要产品为客户个性化定制。成立初期，公司通过上门拜访、他人介绍、参加展会等方式进行客户开发。上市以来，随着公司知名度的提高和产品质量的背书，已经能接触到行业内所有重要的客户，公司当前阶段以维系现有客户关系、深化合作为主，同时在持续开拓电子陶瓷及汽车电子领域。MLCC 业务方面，根据 MLCC 行业属性，公司在该业务领域主要采用经销模式进行市场拓展，伴随产品及销售规模的不断扩大，积极开发终端客户资源。

公司与客户接洽后，会经历一系列资质认证：首先将样品寄送给客户，由对方品质部门、技术部门和采购部门共同测评打分；测评通过后，客户会前来审厂，对公司生产车间和生产流程全面核查；审厂通过后，公司即成为合格供应商，客户会给予一系列爬坡订单。产品生产完成后，由销售部门负责发货和提供售后服务，客户主要对产品的外观和尺寸进行查验，若有不良品，会将外观图片或尺寸数据发回公司，公司对该批次留样品进行排查后，与客户协商修理或进行退换货处理。公司与客户的结算方式主要是银行转账，信用期由公司每年依据客户知名度、信誉程度、合作深度等因素与客户协商确定。

（三）重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。

（四）发行人境外经营情况

截至本募集说明书签署日，发行人不存在境外经营的情况。

五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施

公司通过长期的自主研发和技术积累，形成了覆盖精密制造工艺、光学驱动技术、电子陶瓷材料应用等多方面的核心技术。通过自主研发的核心技术，公司在产品精度、可靠性、集成度等方面保持行业领先水平。截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有专利 296 项，其中发明专利 81 项，并拥有软件著作权 13 项。

同时，公司拥有一支专业的研发团队，具备强大的自主研发能力、丰富的技术经验和创新能力，能够自主设计、开发各种满足客户需求的产品，能够保障公司长期的市场竞争力。

六、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）公司现有业务发展安排

近年来，公司在稳固消费电子主营业务优势的同时，积极布局电子陶瓷赛道，旨在培育业务增长点、构建更具韧性与竞争力的业务生态。在电子陶瓷领域，公司业务分为 MLCC 及 DPC 两部分。MLCC 作为全球用量最大、发展最快的片式电子元器件之一，市场规模庞大。伴随 AI 服务器、汽车电子及 AI 终端等领域的快速发展，其市场规模呈现稳步增长态势。基于长期战略布局，公

司持续加速 MLCC 高容量、小尺寸等重点产品的研发和市场布局，产品尺寸包括 0201、0402、0603、0805、1206 等型号， 应用领域涵盖消费电子、汽车电子、通信及其他工业等市场。在 DPC 方面，伴随着工业激光设备及 T/R 管壳国产化趋势，公司积极跟进陶瓷热沉及 T/R 管壳产品需求，致力于推动相关产品国产化进程， 持续向高附加值业务领域纵深迈进。公司自主开发了预制金锡陶瓷热沉产品， 包括预制金锡的氮化铝、碳化硅等产品，该类产品具有高耐热、高绝缘性、高导热率等特点，被广泛应用于高功率激光器、激光切割、激光焊接、卫星等领域。

在汽车电子领域，公司稳扎稳打，目前已通过比亚迪、京西重工、万向精工、捷太格特、拿森汽车、东洋电装等汽车领域客户认证，公司业务范围覆盖线控底盘制动系统、转向系统以及电子门窗系统，其中，重点布局的线控底盘制动系统领域产品主要包括 ABS、ESC、ONE BOX 等。

（二）公司未来发展战略

1、产品开发计划

公司依托自身数据积淀与研发技术储备， 持续深耕光学主业赛道， 同步加码汽车电子、电子陶瓷业务。公司稳步推进各在研项目有序落地，不断优化产品矩阵，进一步完善产业布局。具体情况如下：

（1）深耕光学领域，向产业链下游转移

历经长期产业深耕与产品战略布局，公司已经积累了摄像头模组 CCM 和音圈马达 VCM 中各核心电子零部件的研发、生产、改进经验，已具备向精密电子零部件集成方案升级的整合能力。公司持续与行业龙头客户合作开发马达，直接参与终端产品的研发设计， 为客户提供产品性能可行性测试。

依托市场沉淀与行业积累，公司拟逐步深化与国内线控底盘主流厂家的协同研发合作，稳步扩大汽车零部件一级供应商的客户群体。未来公司将持续完善线控底盘核心零部件业务布局，力争覆盖细分关键品类，逐步成长为汽车线控底盘领域具备核心竞争力的集成供应商。

（2）研发电子陶瓷产品

公司根据市场需求进行系列产品的策略布局，持续加大材料研发和产品开发力度，提高产品性能以及实现制造成本的优化配置，提升产品盈利能力。公司下一步将从产品尺寸和高容值两个方向去不断研发新的产品规格，并实现产品通过国际电工委员会（IEC）的国际规范测试项目要求，保障后期顺利进入量产作业。同时，公司将加大对可靠性实验室的进一步完善建设，进一步提升产品检测和可靠性验证能力，为后期多规格的高端产品提供高水准的测试环境。公司还将加快质量管理标准体系的获得进度，为后期消费电子领域和汽车电子领域的市场开拓和通过客户相关的认可提供体系认证。

（3）深入汽车领域，进一步拓展市场

公司在汽车精密电子零部件的材料选择、结构设计方面已经取得了丰富的成果，公司已具备对整车电子零部件批量开发的理论及研发基础，目前汽车领域的产品已经实现批量供货。

（4）持续推进在研产品，向行业领先迈进

根据下游行业发展及客户需求，公司进行了部分产品及技术的前瞻性开发，按计划持续推进在研产品项目，增强核心竞争力。

2、技术研发计划

（1）继续完善公司理化实验室的建设

公司将继续完善理化实验室的建设，以满足公司各种产品在性能分析、质量检测等方面的需求。实验室将配备先进的分析设备，包括光谱仪、色谱仪、质谱仪、膜厚测量仪等，并拥有一支专业的分析团队，针对不同的测试需求提供准确、高效的分析服务。实验室的建设遵循国际标准，确保实验室的品质和可靠性。实验室的布局将合理规划，以提高工作效率和保证分析结果的准确性。实验室还将注重环保和安全，配备相应的环保设施和安全设备，确保实验室的运行符合相关法规和标准。在人员配备方面，公司继续扩充专业分析人员队伍，经过严格的培训和考核，使其具备足够的专业技能及素质，以确保能够提供高质量的检测和分析服务。

（2）加强基础材料方面的研究

公司在基础材料研究方面不断进行深入探索，主要致力于研究与公司产品特别是陶瓷电子产品与 MLCC 被动元件产品紧密相关的现有材料的技术升级和新型材料的创新应用，以提高产品的性能和降低生产成本。首先，公司对市场和行业进行了详细的技术调研，了解了当前的市场需求和产品及技术发展趋势，确定了具有潜力的研究方向。同时，公司组织了一支跨学科的研发团队，涵盖化学、物理、材料科学等领域，共同开展基础材料研究。在研究过程中，公司利用自有的理化实验室资源，对材料的物理和化学性质进行深入研究。同时，公司也注重与学术界和产业界的合作，共同推进基础材料相关研究工作的进展。

（3）研发高性能、高技术附加值产品

①公司充分利用在 CMI、CCMI 产品的研发、制造方面的技术优势和积累，不断优化产品性能，丰富产品种类，逐步形成了 CMI、CCMI 产品的规模化效应。在陶瓷基板和 MLCC 产品方面，持续进行产品研发和技术突破，以提升相关产品在该领域的核心竞争力。

②建立完善的产品研发体系。公司已经建立了一套完善的产品研发体系，包括产品策划、设计、开发、测试等各个环节，确保产品的质量和性能达到行业领先水平。

③加强与高校、科研机构的合作。公司与高校、科研机构等开展深入合作，共同研发高性能产品，共享技术和知识产权资源，提升公司的研发能力和水平。

④注重人才培养和引进。公司积极招聘和培养一批高素质、高水平的研发人才，为公司的研发工作提供有力的人才保障。

（4）加强知识产权保护

公司高度重视研发投入和知识产权保护。公司加强对核心技术和产品的专利申请工作，并重点围绕第三代 CMI、第四代 CMI、电子陶瓷及汽车电子等核心技术的研发创新进行了知识产权的保护。公司在 2026 年上半年共获准授权专利 12 项，包括发明专利授权 6 项以及实用新型专利授权 6 项，其中境外专利授权 2 件。2026 年公司继续坚持以技术创新为公司的核心驱动力，推进公司核心技术的不断升级，加强关键核心技术的知识产权保护，形成更多高价值的专利技术产品，同时公司也将加强在海外地区的知识产权保护，进一步完善公司的

核心技术在日本、韩国等海外市场的知识产权布局。

3、市场开拓计划

公司通过以下措施来增强营销力量、实施市场开拓计划：

（1）挖掘 3C 领域核心客户的附加值

公司目前深耕的 3C 产品行业具有供应商认证周期长、准入门槛高、产品更新快等特性，而下游少数客户能占据大部分市场份额，一旦进入下游龙头客户的供应链体系，将会带来持续的生产需求。这些龙头客户生产的终端产品，存在高、中、低端并行的情况，其中高端产品附加值高但生命周期难以预测，倘若上游供应商无法及时跟进产品的配套开发、生产和交付，将难以接触高附加值的订单。未来公司将紧跟 3C 产品和技术的创新趋势，以现有的核心客户及终端用户为发展重点，通过与之深度合作开发高端产品等方式，扩大公司精密电子零部件产品在核心客户高端产品的应用范围，从而提高高附加值产品在公司销售收入中的占比。

（2）扩大汽车电子领域的客户群体且布局新能源核心零件领域

公司在汽车电子领域已经布局多年，目前已经具备深厚的理论和研究基础，同时正在向部分达成合作意向的客户批量出货。未来公司将加大对产品性能的推介，利用之前积累的良好口碑和客户资源，实现汽车电子零部件在汽车领域一级供应商的销售，稳步扩大汽车电子领域销售规模。此外，公司将通过同步研发、生产品类扩大的方式，参与到国内线控底盘主流厂商的新品开发计划中，利用公司研发优势、成本优势取得国内外主流厂商的更多产品应用，并取得 IGBT 市场的认可，从而实现公司高品质、低成本、深度绑定客户的价值目标。

（3）择机拓展产品在其他高端领域的应用

公司已关注到精密注塑和高速冲压等核心技术在工业自动化、医疗器械等领域的应用，积极组织内部人员持续接触相关行业客户需求，改进生产工艺，配套开发新产品，择机进入精密电子零部件的高端应用领域，培育新的盈利增长点。

（4）加强重点区域的营销网络布局

公司国内的客户群体主要集中在资金、技术和人才密集的长三角地区，公司将进一步加强长三角营销队伍的建设，维护好与现有客户的合作关系。同时，公司在珠三角地区建设配套的营销网络，以期拓展此领域的业务规模。通过长三角和珠三角地区的辐射网络，公司将把业务范围拓展得更广。

4、人才发展计划

公司为国家火炬计划重点高新技术企业，先后荣获“2018 年苏州市瞪羚计划企业”、“2019 年度苏州市独角兽培育企业”、“高成长创新型培育企业”、“昆山市劳动关系和谐企业”、国家级专精特新“小巨人”企业。2025 年度，人力资源部围绕公司战略发展，动态优化人才发展规划，确保与企业战略及市场需求同频适配。公司聚焦核心研发团队建设，持续优化人才结构，大力引进高层次人才；完善多元激励机制，实施荣誉表彰与股权激励；构建员工学习成长体系，统筹内外部培训与技能考核，赋能员工能力提升。同时，公司营造积极进取的企业文化，尊重人才、激发团队创新活力，着力打造规模适度、结构合理、素质优良的人才队伍，为企业持续发展提供坚实人才保障。

七、财务性投资情况

（一）财务性投资的认定标准及相关规定

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条规定：“（五）除金融企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”；根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》第八条规定：“截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”；同时根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，财务性投资的界定如下：

1、财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

2、围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷

款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

3、上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求。

4、基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

5、金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

6、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等；

7、发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。

（二）最近一期末发行人持有的财务性投资的情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人资产负债表中与财务性投资相关的会计科目的期末余额情况如下：

单位：万元

序号	科目名称	账面余额	其中财务性投资余额
1	货币资金	4,458.09	-
2	其他应收款	502.20	-
3	其他流动资产	3,171.70	-
4	长期股权投资	2,085.33	-
5	其他非流动资产	4,382.91	-

截至最近一期末，发行人的货币资金中，主要为库存现金、银行存款、信用证及保函保证金，不属于财务性投资。

发行人期末其他应收款主要为押金及保证金，不属于财务性投资。

发行人期末其他流动资产余额为 3,171.70 万元，其中模具和备件的金额为 871.87 万元，待抵扣税金和预缴所得税合计为 2,165.76 万元，其余为保险费、广告费等，均不属于财务性投资。

发行人期末的长期股权投资为公司持有池州昀钐的 19.36%的股权。池州昀

钐原系发行人的控股子公司，主营半导体引线框架业务，是公司主营业务的构成部分之一，2024 年 6 月末，因发行人综合考虑优化资产结构，在该公司增资扩股过程中放弃了优先增资权，使得持股比例下降，并不再纳入合并报表范围。由于池州昀钐为发行人原控股子公司，且与发行人业务关联度较高，故不属于财务性投资。

发行人期末的其他非流动资产为预付的长期资产购置款，主要用于池州昀冢的建设、生产，不属于财务性投资。

综上所述，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资。

（三）自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人已实施或拟实施的财务性投资情况

本次向特定对象发行股票的首次董事会决议日为 2025 年 8 月 29 日，董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，发行人不存在已实施或拟实施的财务性投资的情况。

八、同业竞争情况

（一）同业竞争情况

发行人的主营业务为光学领域精密零部件及汽车电子、电子陶瓷等领域产品的研发、设计、生产制造和销售。截至本募集说明书签署日，除发行人及其控参股子公司外，发行人控股股东、实际控制人王宾控制的其他企业如下：

企业名称	控制关系	经营范围
苏州昀一	王宾担任执行事务合伙人并持股55.53%的企业，发行人员工持股平台	企业管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
苏州昀二	王宾担任执行事务合伙人并持股85.10%的企业，发行人员工持股平台	企业管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
苏州昀三	王宾担任执行事务合伙人并持股93.08%的企业，发行人员工持股平台	企业管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
苏州昀四	王宾担任执行事务合伙人并持股84.06%的企业，发行人员工持股平台	企业管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
池州昀腾企业管理合伙企业（有限合伙）	王宾担任执行事务合伙人并持股0.0977%的企业，发行人子公司池州昀冢的员工持股平台	一般项目：企业管理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

企业名称	控制关系	经营范围
池州昀鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	王宾担任执行事务合伙人并持股2.1084%的企业，发行人子公司池州昀冢的员工持股平台	一般项目：企业管理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上述企业均为发行人及下属子公司员工持股平台，其经营范围与实际从事业务不存在与公司相同、相似等情形，与公司不存在同业竞争或潜在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人王宾已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，相关避免同业竞争的措施切实可行，能够维护公司及中小股东的利益；自承诺函出具以来，控股股东、实际控制人王宾严格遵守其作出的避免同业竞争的承诺，不存在因违反承诺而受到中国证监会及上交所行政处罚、监管措施或者纪律处分的情形，不存在损害公司利益的情形。

九、关于违法行为、资本市场失信惩戒相关信息

（一）公司相关信息

公司最近三年不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查情形，不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

（二）公司控股股东、实际控制人相关信息核查

公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

（三）公司现任董事和高级管理人员相关信息核查

公司现任董事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一年未受到证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员不存在《发行注册管理办法》第十一条（三）至（六）的情形及《证券期货法律适用意见第 18 号》第二条规定的不得向特定对象发行股票的情形。

第二章 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、新型电子元件产品受到国家政策的广泛支持

新型电子元器件是支撑国家信息技术产业发展的核心元素和关键基础，对整个电子信息制造业的技术水平和稳定性提升起到决定性作用。在当前复杂多变的国际政治经济环境下，电子元器件及相关关键材料、制造设备的“自主可控”性显得尤为重要。近年来《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《中国电子元器件行业“十四五”发展规划（2021-2025）》《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等扶持政策陆续发布，在关键基础电子材料、电子元器件及相关专用设备、先进工艺等领域提出了一系列具体举措，旨在突破核心技术，提升产业竞争力，为行业内企业提供了良好的发展环境。

2、电子陶瓷产业蓬勃发展，国内企业实现技术突围

随着电子信息制造业、新能源等领域的快速发展，电子陶瓷因耐高温、耐腐蚀、稳定性高、机械强度高等性能优势在消费电子、能源、家用电器、汽车、AI 等领域得到了极为广泛的应用。我国是电子陶瓷消费大国，但目前电子陶瓷核心材料、制造工业和产品的全球市场份额仍长期被日本、美国等企业占据。

近年来，随着我国制造业整体产业技术工艺的持续升级，以及研发投入、研发能力的持续提升，加之《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》《“十四五”原材料工业发展规划》等扶持政策的持续推出，部分国内企业在电子陶瓷研发、生产技术工艺、制造设备等方面均实现了较为可观的技术进步，市场份额逐步提升，产品市场竞争力日益增强，电子陶瓷相关产业发展潜力巨大。

3、高端化浪潮下，MLCC 行业开启新一轮上行周期

近年来，MLCC 行业呈现显著成长性，并经历了深刻的结构性变革。在全球市场规模持续扩容的同时，需求结构由传统消费电子向 AI 服务器、汽车电子等高附加值领域加速迁移：AI 服务器因架构升级与功耗大幅提升，单机 MLCC 用量可达传统通用服务器约 8-10 倍；新能源汽车单车 MLCC 用量可达燃油车约 6 倍。高端领域需求集中释放，驱动产品向高容值、超小型、高可靠方向加速迭代。在此背景下，日韩龙头企业（如村田、三星电机）产能加速向 AI 及车规级产品切换，消费级产能被持续挤压，供给约束引发供应链传导效应。自 2026 年以来行业稼动率高位运行，部分型号产品供不应求，现货市场价格波动上行，头部厂商开启新一轮提价周期，行业整体进入“量增、价涨、利升”的景气通道。

4、随着公司业务的发展，对资金的需求进一步提升

公司近年来除了在原有支柱业务消费电子业务保持投入外，凭借在消费电子领域拥有的成熟工艺和技术，公司还积极开拓电子陶瓷市场、汽车电子市场。前期公司主要通过自有资金及银行贷款进行投入，随着公司业务的持续发展，公司对资金的需求进一步提升。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、提升产品的供应能力，加强规模效应，提升公司竞争力

公司 DPC 及 MLCC 产品产能利用率目前均处于较高水平，通过本次募投项目的建设，能够有效缓解上述产品的产能瓶颈问题，突破因供应能力不足所导致的现有市场份额边界，持续扩大与现有客户合作，并为新客户的开拓提供产能支撑，进一步释放公司业务增长潜力。产能的扩大也能为公司带来显著的规模效应，在提升公司业务规模的同时降低单位成本，增强公司的盈利能力，从而提高公司竞争力。

2、积极拓展业务布局，推动新的业绩增长点

近年来，公司在稳固消费电子主营业务优势的同时，积极布局电子陶瓷新赛道，旨在培育业务增长点、构建更具韧性与竞争力的业务生态。DPC 和 MLCC 业务均是公司在电子陶瓷领域的重要布局，公司通过本次募投项目的建

设，能够抓住市场机遇，进一步完善公司在电子陶瓷领域的产品矩阵，提升高端产品产能，未来逐步向航天卫星、光通信、汽车电子、AI 等高价值的应用场景渗透，推动新的业绩增长点，保障公司未来的可持续发展。

3、优化资本结构，提高抗风险能力

截至 2026 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 89.20%，处于较高水平。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行贷款，有利于优化公司的资本结构，降低资产负债率，提高公司抗风险的能力，促进公司长期稳定的发展。

二、发行对象及其与公司的关系

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次向特定对象发行的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

截至本募集说明书签署日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

三、本次向特定对象发行股票方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股份。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生因派息、送股、资本公积转增股 本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。调整方式如下：

派发现金股利：$P_1=P_0-D$

送股或转增股本：$P_1=P_0/(1+N)$

派发现金同时送股或转增股本：$P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中，P_0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，调整后发行底价为 P_1。

最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士在股东会的授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐人（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 36,000,000 股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会或其授权人士根据股东会的授权结合最终发行价格与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销股票等事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若国家法律、法规及规范性文件、监管政策变化或根据发行注册文件要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。

（六）募集资金规模及用途

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 **81,000.00 万元**，扣除发行费用后，实际募集资金将用于“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	DPC 智能化产线技改扩建项目	18,000.00	17,050.00
2	片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目	35,000.00	25,440.00
3	高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目	18,993.10	18,993.10
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	**19,516.90**	**19,516.90**
合计		**91,510.00**	**81,000.00**

募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金投资金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

（七）限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

（八）股票上市地点

在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（九）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

（十）本次发行决议的有效期限

本次发行相关决议的有效期为公司股东会审议通过之日起 12 个月。

经公司 2025 年年度股东会审议通过，本次发行相关决议的有效期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的有效期届满之日起延长 12 个月至 2027 年 10 月 14 日。

本次向特定对象发行方案尚需按照有关程序向上海证券交易所申报，并最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

四、募集资金投向

进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 **81,000.00 万元**，扣除发行费用后，实际募集资金将用于“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	DPC 智能化产线技改扩建项目	18,000.00	17,050.00
2	片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目	35,000.00	25,440.00
3	高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目	18,993.10	18,993.10
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	**19,516.90**	**19,516.90**
合计		**91,510.00**	**81,000.00**

募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金投资金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募

集资金予以置换。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。最终本次发行是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行前，公司的控股股东、实际控制人为王宾先生。截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宾先生直接持有公司股份 10,023,220 股，占公司总股本的 8.35%，其一致行动人苏州昀一、苏州昀二、苏州昀三、苏州昀四合计持有公司 37,398,800 股，占公司总股本的 31.17%。王宾先生直接持股及通过一致行动人合计控制公司 39.52%的表决权。

本次向特定对象发行股票数量不超过 36,000,000 股，若假设本次发行股票数量为发行上限 36,000,000 股，则本次发行完成后，公司的总股本为 156,000,000 股，王宾先生直接持股及通过苏州昀一、苏州昀二、苏州昀三、苏州昀四，将合计拥有公司 30.40%的表决权，仍为公司的控股股东、实际控制人。

因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

七、本次发行是否会导致公司股权分布不具备上市条件

本次向特定对象发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”

（一）关于本次证券发行数量

上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且

不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 36,000,000 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

（二）关于融资间隔

上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。

前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。

公司本次发行的董事会决议距公司前次募集资金到位日已超过 18 个月，符合融资时间间隔的要求。

（三）关于募集资金用于补充流动资金和偿还债务等非资本性支出

通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发投入特点的企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应当充分论证其合理性，且超过部分原则上应当用于主营业务相关的研发投入。本次募集资金总额为 **81,000.00 *万元***，将用于“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”“补充流动资金及偿还银行贷款项目”。本次募集资金主要投向主业，其中用于补充流动资金及偿还银行贷款项目及项目非资本性支出的金额为 **19,516.90 *万元***，占募集资金的比例为 **24.09%**。

综上，本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定。

九、本次发行符合《管理办法》第十一条规定的情形

发行人不存在《管理办法》第十一条规定的下述不得向特定对象发行股票的情形：

（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

十、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序

根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票方案已经 **2025 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会、2026 年 6 月 9 日召开的第三届董事会第六次会议、2026 年 6 月 30 日召开的 2025 年年度股东会、2026 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过**。

经公司 2025 年年度股东会审议通过，本次发行相关决议的有效期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的有效期届满之日起延长 12 个月至 2027 年 10 月 14 日。

根据相关法律法规的规定，本次发行尚需取得上海证券交易所审核通过并

经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。在获得中国证监会同意注册后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部批准程序。

第三章 董事会关于本次募集资金的可行性分析

一、本次向特定对象发行的募集资金使用计划

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 **81,000.00 万元**，扣除发行费用后，实际募集资金将用于“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”以及“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额	拟实施主体	项目备案情况	项目环评情况
1	DPC 智能化产线技改扩建项目	18,000.00	17,050.00	池州昀海	项目备案代码：2505-341763-04-02-347967	（池环函〔2026〕14 号）
2	片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目	35,000.00	25,440.00	池州昀冢	项目备案代码：2504-341763-04-02-543976	（江南环审〔2022〕1 号）
3	高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目	18,993.10	18,993.10	池州昀冢	项目备案代码：2606-341763-04-02-968214	
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	**19,516.90**	**19,516.90**	-	-	-
合计		**91,510.00**	**81,000.00**	-	-	-

募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金投资金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系

公司是一家专业从事消费电子光学、汽车电子、电子陶瓷等领域精密电子零部件产品研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业。自成立以来，公司即专注于消费电子光学领域，该业务一直为公司的支柱业务之一。近年来，在保持消费电子主营业务优势的基础上，公司积极布局汽车电子、电子陶瓷领域业务，力求在新赛道上培育增长点，构建更具韧性与竞争力的业务生态。目前在汽车电子及电子陶瓷领域也均实现了大规模量产，形成了多行业自主产品矩阵。

公司本次募投项目紧密围绕现有主营业务，并基于当前现有成熟业务技术展开，报告期内均已形成一定产能规模。“DPC 智能化产线技改扩建项目”、“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”和“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”均投向电子陶瓷领域，系公司顺应行业发展趋势，响应下游客户需求，优化公司产品结构而做出的重要布局，有利于公司优化生产布局，提高 DPC 及 MLCC 产品尤其是其中高端产品的产能，提升技术能力，增加公司竞争力。公司生产经营对流动资金要求较高，目前的资产负债率也处于较高水平，本次补充流动资金及偿还银行贷款项目能够改善公司资本结构，并为未来公司业务的持续发展提供一定的资金保障。

三、本次募集资金投资项目实施的必要性及可行性

（一）项目实施必要性

1、积极拓展公司业务布局，推动业务新增长极及公司中长期发展战略落地

近年来，公司在稳固消费电子主营业务优势的同时，积极布局电子陶瓷新赛道，旨在培育业务增长点、构建更具韧性与竞争力的业务生态。

DPC 产品具有导热/耐热性好、图形精度高、可垂直互连及热膨胀系数与芯片匹配等特性，未来在工业激光、车载激光、航天卫星、光通信等高端应用领域拥有广阔的应用前景。其作为公司电子陶瓷领域的核心拓展方向之一，已于 2024 年取得关键性突破，产品切入激光热沉、T/R 管壳等领域，业务呈现快速增长的积极态势。基于这一良好发展基础，公司需进一步加大该业务的投资力度，推动其成为新增长极，助力整体业务持续升级。

MLCC 作为全球用量最大、发展最快的片式电子元器件之一，凭借千亿级市场规模、下游需求高增长、应用场景广覆盖及显著的国产替代空间，成为电子元器件产业中极具战略价值的赛道。基于此，公司明确将 MLCC 纳入中长期策略发展重点方向，将其作为夯实业务新增长曲线的关键抓手，持续加大研发投入与生产布局力度。公司目前已实现 0201、0402、0603、0805、1206 等多尺寸系列产品的研发及生产，可满足下游多领域应用需求。同时正加速更高规格产品的核心技术攻关与市场拓展，进一步完善产品矩阵，逐步覆盖更高价值的应用场景，为公司构建长期、稳定的新增长曲线筑牢底层支撑。

本次募投项目计划对 DPC 和 MLCC 产线进行技术升级改造，快速提升电子陶瓷业务产能规模与质量稳定性，并为更高规格产品的研发生产提供硬件支撑，夯实业务新增长曲线底层基础，推动公司中长期战略稳步落地。

2、通过 DPC 产线升级改造，实现向高附加值产品转换

在公司 DPC 业务发展初期，产品主要应用于 LED 陶瓷热沉基板领域。伴随着工业激光设备及 T/R 管壳国产化趋势，公司积极跟进上述领域陶瓷热沉及管壳产品需求，致力于推动相关产品国产化进程，填补相关国产组件市场需求，向更高产品附加值领域迈进。经过多年的技术研发及市场开拓，目前公司产品已成功切入上述领域，相关产品出货量实现快速增长。

本次募投计划通过对 DPC 业务部分老旧产线进行淘汰及改造，满足工业激光设备、航天卫星等下游领域产品生产要求。项目有利于实现公司陶瓷基板产品整体向高附加值产品的转换，增强公司业务盈利水平，抓住市场机遇，保障公司未来的可持续发展。

3、助力 MLCC 国产化，填补高容产品需求

MLCC 作为电子电路中的核心被动元器件，广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制等领域，其供应链安全与自主可控对我国电子信息产业发展至关重要。当前，国内中低端 MLCC 产能已逐步实现自主供应，但在高容量、高可靠性等高端 MLCC 产品领域，仍存在一定进口依赖，尤其随着新能源汽车、5G 通信、AI 等下游行业快速发展，高容 MLCC 市场需求持续攀升，供需缺口成为制约产业链升级的关键环节。在此背景下，助力 MLCC 国产化替代、填补

高容产品需求，既是突破供应链难题的重要举措，也是推动国内电子元器件产业向高端化升级的核心方向。

本次募投计划通过对现有产线进行技术升级改造，优化生产工艺，进一步提升公司高容产品良率、稳定性及生产规模，帮助满足国内下游终端企业对高容 MLCC 的迫切需求，降低产业链采购成本与供应链风险，完善国内 MLCC 产业生态，提升我国在全球电子元器件领域的核心竞争力，为我国电子信息产业高质量发展筑牢基础。

4、加强产品生产能力，匹配业务增长需求

经过长期技术探索、多轮严格测试验证以及积极的客户开拓工作，公司大功率激光用热沉及 T/R 管壳产品凭借高可靠性能与品质获得了客户的认可，不仅成功获取了稳定订单，产品市场需求更是实现快速攀升，但当前产能不足的核心瓶颈十分突出，现有产能仅能勉强满足少数合作客户的供应需求，供货能力的短缺不仅让公司错失了大量潜在客户的合作机会，更严重制约了新客户拓展的步伐，难以进一步扩大市场份额、释放业务增长潜力。公司 MLCC 业务亦呈现显著增长态势，产品市场需求持续攀升，公司 MLCC 产品产销衔接高效，已基本实现“产出即销售”的良好局面，生产线长期保持满负荷运行状态，现有产能已难以进一步承接新增订单。

本次募投计划通过进一步扩大 DPC 和 MLCC 业务生产规模，突破因产能不足所导致的现有市场份额边界，持续扩大与现有客户合作能力，并为新客户、新应用场景的开拓提供产能支撑，推动业务规模与盈利能力持续提升。

5、满足业务扩张资金需求，优化资本结构

近年来，公司在稳固消费电子业务的同时，积极布局汽车电子与电子陶瓷等新赛道，业务快速扩张使得流动资金需求也随之增加。此外，截至 2026 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 89.20%，已处于较高水平。

本次向特定对象发行股票募集资金部分拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。这一举措既能缓解业务扩张带来的资金缺口，为人才建设、研发投入及日常运营提供支持，巩固行业地位；又能有效优化公司资本结构，降低资产负债率，提升公司抗风险能力与综合竞争力，保障公司长期稳定发展。

（二）项目实施可行性

1、项目建设符合国家相关政策导向

本次募投项目涉及的 DPC 陶瓷基板与 MLCC 产品，均属于国家战略性新兴产业的重点支持范畴。近年来，国家陆续出台《“十四五”原材料工业发展规划》、《基础电子元器件产业发展行动计划》、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等多项重磅文件，明确将高端电子陶瓷材料、高端热沉器件、核心电子元器件列为重点发展对象，强调提升产业链自主可控能力与可靠性水平。

本次募投旨在扩大 DPC 陶瓷基板及高容 MLCC 产品的产能，契合国家产业政策导向，相关政策将为本次募投的顺利实施与落地提供有力支持。

2、下游市场需求的快速增长为项目实施提供良好保障

在 DPC 陶瓷基板应用方面，受益激光产业升级及卫星互联网建设，下游需求旺盛。根据《2026 中国激光产业发展报告》数据显示，2025 年，全球激光设备市场销售收入约为 240 亿美元，其中中国激光设备市场销售收入约 958 亿元，占比达到全球市场的 58%，保持稳步增长。预计 2026 年，全球及中国激光设备市场规模将分别达到 262 亿美元和 1,025 亿元。同时，公司 T/R 管壳主要应用于雷达及卫星领域。根据 AIoT 星图研究院数据，2023 年我国车载激光雷达出货量约为 71 万台，预计 2027 年出货量将达到 857 万台。在卫星领域，根据 BryceTech 数据显示，2024 年全球发射小卫星 2,790 颗，创历史新高，其中通信卫星比例在 2019 年后显著增加，最近几年占比均超过 70%；近 10 年小卫星发射次数由 2015 年的 33 次，快速增长至 2024 年的 199 次，预计未来卫星发射数量仍将持续攀升。车载激光雷达及卫星发射数量的爆发式增长，直接拉动了对 T/R 管壳的需求。

在 MLCC 应用方面，行业已走出周期低谷，重回增长轨道。根据赛迪顾问数据，2024 年全球及中国 MLCC 市场规模分别达 231.3 亿美元和 544.4 亿元，同比增长分别达到 7.5%和 11.8%。随着 5G 通信、汽车电子、人工智能等领域的技术突破与市场扩张，全球 MLCC 市场需求将迎来爆发式增长，预计从 2024 年的 231.3 亿美元增长到 2027 年的 334.1 亿美元，年复合增长率达 13.0%。

下游市场需求的快速增长为本次募投的产能消化提供了良好保障。

3、优秀的产品性能及优质的客户资源为项目实施奠定坚实基础

在 DPC 陶瓷基板领域，公司已实现从技术突破到规模化量产的跨越，是行业内少有实现 100%全流程自制的制造商。公司产品在尺寸精度、平整度、均匀性、稳定性等方面上表现优异，并已成功导入行业头部客户供应链，客户粘性强，订单放量趋势明确。在 MLCC 领域，公司虽为行业后起之秀，但凭借长期扎实的研发积累与严苛的测试验证，在产品性能上已建立起口碑优势。市场端，公司也已与业内知名经销商建立了长期稳固的战略合作关系，渠道通路顺畅，品牌知名度和认可度快速提升。

优秀的产品性能优势与优质的客户储备，为本次募投项目的顺利实施与产能消化奠定了坚实基础。

4、公司实力雄厚的核心团队与技术优势有效保障本项目的顺利实施

DPC 业务方面，公司组建了专注于高导热陶瓷线路板工艺开发与量产的资深技术团队，拥有覆盖产品设计开发、DPC 基板生产、表面处理、质量检测至贵金属回收制备的全流程自制能力，核心生产工艺与关键设备全面自主可控，从而既提升了生产效率和产品质量稳定性，又通过成本控制强化了竞争力。MLCC 业务方面，公司自 2021 年组建核心团队，部分骨干成员来自头部 MLCC 企业，已逐步攻克材料配方、精密印刷、叠层烧结等核心技术，有效降低对进口材料的依赖，实现部分关键材料自主可控。同时，依托公司自动化设备技术支持，已完成部分核心生产设备的自主开发，可显著提升产线智能化水平，推动产品良率持续改善，降低生产制造成本。

公司核心团队凭借深厚的行业经验与技术积累，为项目技改扩产提供保障。

5、本次发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件，公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

本次向特定对象发行股票募集资金拟部分用于补充流动资金及偿还银行贷款，符合《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规，发行方案合法合规，具备可行性。

同时，公司已建立健全规范的法人治理结构及内部控制体系，并制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用及监督进行全流程规范，能够保障本次募集资金的安全、合规使用，有效防范财务风险。

四、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）DPC 智能化产线技改扩建项目

1、项目概述

本项目拟投资 18,000.00 万元，其中拟使用募集资金金额 17,050.00 万元，主要投资内容包括场地装修改造、设备购置及安装、铺底流动资金等必要投资。项目计划对当前 DPC 业务产线进行自动化、智能化、柔性化技术升级改造，加快实现陶瓷热沉等产品规模化发展，持续扩大现有客户合作能力，并为新客户的开拓合作提供产能支撑，进一步释放公司业务增长潜力，实现公司电子陶瓷产品整体向高附加值产品的转换，推动业务新增长极。

2、项目投资概算

本项目总投资为 18,000.00 万元，其中拟使用募集资金金额 17,050.00 万元，铺底流动资金拟全部使用自筹资金投入。具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	场地装修改造	2,850.00	15.83%
2	设备购置及安装	14,719.00	81.77%
3	铺底流动资金	431.00	2.39%
合计		**18,000.00**	**100.00%**

3、实施主体和项目选址

本项目实施主体为池州昀海陶电科技有限公司，系公司控股子公司，实施地点为安徽省池州市。

4、实施进度安排

本项目计划建设期为 2 年。项目建设期的主要工作包括：工程前期工作、工程建设、设备购置及安装调试、系统运行等，具体实施进度如下：

项目实施进度表

项目	T+1				T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程前期工作								
工程建设								
设备购置及安装调试								
系统运行								
竣工验收								

5、效益预测的假设条件及主要计算过程

募投项目效益预测系公司基于当前市场情况对募投项目效益的合理预期，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况变化等多种因素。

根据测算，本项目建成后，项目内部收益率所得税后为 22.96%，税后投资回收期为 5.45 年（含建设期 2 年），项目具有较好的经济效益。本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

（1）收入测算

本项目收入主要来自陶瓷热沉和 T/R 管壳产品销售，预计第 5 年实现达产。

本项目销售收入根据产品预计销售价格乘以当年预计销量进行测算。其中，本项目产品销售价格测算系公司根据同类产品历史价格情况谨慎预估，并在项目 T+4 年开始按 5%逐年下降；本项目产品销量系公司根据设计产能、综合考虑客户及下游市场需求等因素进行合理估算。

（2）营业成本测算

本项目营业成本主要由直接材料、直接人工、制造费用及折旧摊销构成。具体测算依据如下：

序号	项目	预测依据
1.1	直接材料	本项目直接材料根据公司报告期内历史数据结合募投项目产品特点按照其占收入的比例进行估算。
1.2	直接人工	本项目直接人工根据公司报告期内历史数据并参照项目所需直接生产人员人数及公司职工薪酬水平进行估算。
1.3	制造费用	本项目制造费用参照公司过往同性质产品制造费用支出情况进行估算。
1.4	折旧摊销	主要系项目建设期内设备购置及安装支出所致，折旧金额系根据公司现有政策进行谨慎估算。

（3）期间费用测算

本项目期间费用主要包括销售费用、管理费用和研发费用，依据同行业历史期间费用率及项目实际情况进行预测。

（4）税费测算

税率主要根据本项目实施主体目前适用税率进行计算。本项目实施主体为池州昀海陶电科技有限公司，其中，增值税按照 13%计算，企业所得税按照 25%计算，城建税按照 5%计算，教育费附加（含地方教育费附加）按照 5%计算。

6、项目涉及报批事项情况

截至本募集说明书签署日，本募投项目已完成备案及环评手续：取得了《皖江江南新兴产业集中区产业发展部备案表》（项目代码：2505-341763-04-02-347967）；取得了《池州市生态环境局关于池州昀海陶电科技有限公司 DPC 智能化产线技改扩建项目环境影响报告书审批意见的函》（池环函〔2026〕14 号）。

（二）片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目

1、项目概述

本项目拟投资 35,000.00 万元，其中拟使用募集资金金额 25,440.00 万元，主要投资内容包括设备购置及安装、铺底流动资金等必要投资。项目主要为进一步推动公司电子陶瓷业务中长期策略发展方向，计划通过新增生产线、优化生产布局、升级现有产能等方式，提升 MLCC 产品的整体产能供给能力，进一步提升公司高容产品良率、稳定性及生产规模，夯实业务新增长曲线底层支撑，助力公司加强 MLCC 业务的市场优势，推动业务规模与盈利能力持续提升。

2、项目投资概算

本项目总投资为 35,000.00 万元，其中拟使用募集资金金额 25,440.00 万元，铺底流动资金拟全部使用自筹资金投入。具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	设备购置及安装	34,538.00	98.68%
2	铺底流动资金	462.00	1.32%
项目总投资		**35,000.00**	**100.00%**

3、实施主体和项目选址

本项目实施主体为池州昀冢电子科技有限公司，系公司控股子公司，实施地点为安徽省池州市。

4、实施进度安排

本项目计划建设期为 2 年。项目建设期的主要工作包括：项目前期工作、设备购置及安装调试、系统运行等，具体实施进度如下：

项目实施进度表

项目	T+1				T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目前期工作								
设备购置及安装调试								
系统运行								
竣工验收								

5、效益预测的假设条件及主要计算过程

募投项目效益预测系公司基于当前市场情况对募投项目效益的合理预期，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况变化等多种因素。

根据测算，本项目内部收益率所得税后为 13.99%，税后投资回收期为 6.95 年（含建设期 2 年），项目具有较好的经济效益。本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

（1）收入测算

本项目收入主要来自 MLCC 各系列产品销售，预计第 4 年实现达产。

本项目销售收入根据产品预计销售价格乘以当年预计销量进行测算。其中，本项目产品销售价格测算系公司根据同类产品市场价格情况谨慎预估；本项目

产品销量系公司根据设计产能、综合考虑客户及下游市场需求等因素进行合理估算。

（2）营业成本测算

本项目营业成本主要由直接材料、直接人工、制造费用及折旧摊销构成。具体测算依据如下：

序号	项目	预测依据
1.1	直接材料	本项目直接材料根据公司报告期内历史数据结合募投项目产品特点按照其占收入的比例进行估算。
1.2	直接人工	本项目直接人工根据公司报告期内历史数据并参照项目所需直接生产人员人数及公司职工薪酬水平进行估算。
1.3	制造费用	本项目制造费用参照公司过往同性质产品制造费用支出情况进行估算。
1.4	折旧摊销	主要系项目建设期内设备购置及安装支出所致，折旧金额系根据公司现有政策进行谨慎估算。

（3）期间费用测算

本项目期间费用主要包括销售费用、管理费用和研发费用，依据同行业历史期间费用率及项目实际情况进行预测。

（4）税费测算

税率主要根据本项目实施主体目前适用税率进行计算。本项目实施主体为池州昀冢电子科技有限公司，其中，增值税按照 13%计算，企业所得税按照 15%计算，城建税按照 5%计算，教育费附加（含地方教育费附加）按照 5%计算。

6、项目涉及报批事项情况

截至本募集说明书签署日，本募投项目已完成备案及环评手续：取得了《皖江江南新兴产业集中区产业发展部项目备案表》（项目代码：2504-341763-04-02-543976）；取得了《皖江江南新兴产业集中区生态环境局关于池州昀冢电子科技有限公司片式多层陶瓷电容器项目环境影响报告表的批复》（江南环审〔2022〕1 号）。

（三）高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目

1、项目概述

本项目拟投资 18,993.10 万元，其中拟使用募集资金金额 18,993.10 万元，

均用于设备购置及安装。本项目计划通过购置先进设备并应用创新生产技术，提高生产效率并降低生产能耗，同时进一步扩增公司 MLCC 高容产品系列品项，提升公司 MLCC 业务规模及竞争力。

2、项目投资概算

本项目总投资为 18,993.10 万元，其中拟使用募集资金金额 18,993.10 万元。具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	设备购置及安装	18,993.10	100.00%
合计		**18,993.10**	**100.00%**

3、实施主体和项目选址

项目的实施主体是池州昀冢电子科技有限公司，系公司控股子公司，实施地点为安徽省池州市。

4、实施进度安排

本项目计划建设期为 1 年。项目建设期的主要工作包括：项目前期工作、设备购置及安装调试、系统运行等，具体实施进度如下：

项目实施进度表

项目	T+1			
	Q1	Q2	Q3	Q4
工程前期工作				
设备购置及安装调试				
系统运行				
竣工验收				

5、效益预测的假设条件及主要计算过程

募投项目效益预测系公司基于当前市场情况对募投项目效益的合理预期，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况变化等多种因素。

根据测算，本项目内部收益率所得税后为 28.52%，税后投资回收期为 4.19 年（含建设期 1 年），项目具有较好的经济效益。本项目效益预测的假设条件

及主要计算过程如下：

（1）收入测算

本项目收入主要来自 MLCC 高容产品销售，项目预计于第 2 年全部达产。本项目销售收入根据产品预计销售价格乘以当年预计销量进行测算。其中，本项目产品销售价格测算系公司根据同类产品市场价格情况谨慎预估；本项目产品销量系公司根据设计产能、综合考虑客户及下游市场需求等因素进行合理估算。

（2）营业成本测算

本项目营业成本主要由直接材料、直接人工、制造费用及折旧摊销构成。具体测算依据如下：

序号	项目	预测依据
1.1	直接材料	本项目直接材料根据公司报告期内历史数据结合募投项目产品特点按照其占收入的比例进行估算。
1.2	直接人工	本项目直接人工根据公司报告期内历史数据并参照项目所需直接生产人员人数及公司职工薪酬水平进行估算。
1.3	制造费用	本项目制造费用参照公司过往同性质产品制造费用支出情况进行估算。
1.4	折旧摊销	主要系项目建设期内设备购置及安装支出所致，折旧金额系根据公司现有政策进行谨慎估算。

（3）期间费用测算

本项目期间费用主要包括销售费用、管理费用和研发费用，依据同行业历史期间费用率及项目实际情况进行预测。

（4）税费测算

税率主要根据本项目实施主体目前适用税率进行计算。本项目实施主体为池州昀冢电子科技有限公司，其中，增值税按照 13%计算，企业所得税按照 15%计算，城建税按照 5%计算，教育费附加（含地方教育费附加）按照 5%计算。

6、项目涉及报批事项情况

截至本募集说明书签署日，本募投项目已完成备案及环评手续：取得了《皖江江南新兴产业集中区产业发展部备案表》（项目代码：2606-341763-04-02-968214）；取得了《皖江江南新兴产业集中区生态环境局关于池州昀冢电子

科技有限公司片式多层陶瓷电容器项目环境影响报告表的批复》（江南环审〔2022〕1号）。

（四）补充流动资金及偿还银行贷款项目

公司基于业务快速发展对流动资金的需求，拟使用本次募集资金中**19,516.90 万元**补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司经营资金需求，优化资产结构，降低财务费用，增强公司的抗风险能力。

五、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司主要从事消费电子及电子陶瓷、汽车电子等领域产品的研发、设计、生产制造和销售。公司所属行业领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》第五条规定的“（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”，公司主营业务属于科技创新领域。

公司本次募投项目紧密围绕公司主营业务展开，包括“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款项目”。上述募集资金投资项目有利于公司提升技术水平，丰富和改善产品结构，提高市场占有率及竞争力，推动关键元件国产化进程。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

通过本次募投项目的实施，公司将进一步提升在电子陶瓷领域的技术水平，优化生产研发布局，提高产品产能，从而促进主营业务发展，推动公司科技创新水平的持续提升。

未来，公司将继续通过研发投入及技术创新，推动公司产品竞争力和市场地位不断提升。

六、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

公司本次募集资金将用于“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，是公司为顺应公司战略发展而做出的重要布局。

DPC 智能化产线技改扩建项目、片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目及高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目均是基于公司中长期发展战略以及当前公司电子陶瓷产品营收实现快速放量的态势下，通过对产线进行技改升级，提升相关产品的整体产能供给能力，并满足公司高规格产品的生产要素，进一步释放公司业务增长潜力，推动公司业务新增长极。补充流动资金及偿还银行贷款项目则是通过注入流动性资金与降低债务负担，缓解公司资金周转压力，助力业务正向发展。

本次发行能够进一步提升公司的资本实力，增强公司的技术实力和服务能力，从而进一步提升公司品牌影响力、扩大公司市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈利水平和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将有所提升，财务状况将有所改善，抗风险能力将进一步提升。但由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，可能在短期内难以实现预期效益，存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。本次募集资金投资项目具有良好的市场前景、经济效益和社会效益，未来随着项目的运营实施，公司的经营规模和盈利水平将进一步增强，财务状况得到进一步改善，最终将会推动公司的业务规模和盈利能力进一步提升。

七、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”的情况

（一）本次发行满足“两符合”相关规定

1、符合国家产业政策的情况

公司主要从事消费电子及电子陶瓷、汽车电子等领域产品的研发、设计、生产制造和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019 年修订），公司的主营业务属于“C 制造业”大类下“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中“C3989 其他电子元件制造”，细分行业为精密电子零部件制造业。根据国家统计局发布的《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”，符合战略新兴产业的发展方向。

本次募集资金投资项目包括“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》“鼓励类”项目，不涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业、高耗能、高排放行业，符合国家产业政策要求。

2、关于募集资金投向与主业的关系

公司本次募投项目紧密围绕公司主营业务展开，包括“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款项目”。上述募集资金投资项目有利于公司提升技术水平，丰富和改善产品结构，提高市场占有率及竞争力，推动关键元件国产化进程。

（二）本次发行不涉及“四重大”相关情形

截至本募集说明书签署日，公司主营业务及本次发行募投项目不涉及情况特殊、复杂敏感、审慎论证的事项；公司本次发行不存在重大无先例事项，不存在影响本次发行的重大舆情，未发现公司存在相关投诉举报、信访等重大违法违规线索，本次发行满足《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。

综上，本次发行满足“两符合”，不涉及“四重大”。

第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析

一、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合产业发展方向和公司战略布局。本次发行完成后，公司的主营业务不会发生重大变化。公司不存在因本次发行而导致的业务及资产整合计划。

二、本次发行完成后上市公司科研创新能力的变化

通过本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施，有助于公司实现战略目标，增强公司的资本实力，加大公司的研发投入，加快公司研发技术产业化进程，提升公司科研创新能力和技术研发水平。

三、本次发行完成后上市公司控制权结构的变化

截至本募集说明书签署日，公司实际控制人为王宾。王宾直接持有公司股份 10,023,220 股，占公司总股本的 8.35%，其一致行动人苏州昀一、苏州昀二、苏州昀三、苏州昀四合计持有公司 37,398,800 股，占公司总股本的 31.17%。王宾先生直接持股并通过一致行动人合计控制公司 39.52%的表决权。

本次向特定对象发行股票数量不超过 36,000,000 股，若假设本次发行股票数量为发行上限 36,000,000 股，则本次发行完成后，公司的总股本为 156,000,000 股，王宾控制公司 30.40%股份的表决权（假设其不参与本次向特定对象发行的认购且不减持公司股份的情况下），为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。本次发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。同时，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、本次发行完成后上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

截至本募集说明书签署日，发行人本次发行尚无确定的发行对象。本次发

行完成后，最终是否可能存在与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

五、本次发行完成后上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购发行人本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。发行人将严格按照中国证监会、上交所及发行人内部规定履行必要程序，遵循公允、合理的市场定价原则，保证交易的合法性和交易价格的公允性。

六、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化

本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资金需求，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展。本次募集资金投向紧密围绕公司主营业务开展，属于科技创新领域，公司将持续进行研发投入，有效提升公司的科研创新能力。

第五章 历次募集资金的使用情况

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

（一）前次募集资金的募集情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昀冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]606 号文）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2021 年 3 月 23 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 9.63 元，共计募集资金人民币 288,900,000.00 元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 28,670,000.00 元后实际到位资金为人民币 260,230,000.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 29 日汇入本公司指定账户。

本次发行的保荐承销费、会计师审计验资费、律师费、本次发行的信息披露费、发行手续及材料制作费用等直接相关的发行费用合计为 43,340,002.42 元（含税），扣除增值税后的发行费用为 40,890,319.81 元，实际募集资金净额为人民币 248,009,680.19 元。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00035 号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至 **2026 年 6 月 30 日**，公司前次募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	288,900,000.00
减：发行费用	40,890,319.81
减：募集资金投资项目先期投入及置换	57,224,784.28
减：募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	53,421,725.88
减：募集资金补充流动资金	138,274,742.66
减：销户资金划转基本户	256.71
减：手续费用支出	870.61

项目	金额
加：累计利息收入	121,607.57
加：理财产品投资收益	791,092.38
合计	-

（二）前次募集资金的使用情况

1、前次募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金总额				24,800.97	已累计使用募集资金总额				24,892.13	
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	各年度使用募集资金总额：2021 年度				22,283.97	
累计变更用途的募集资金总额				0.00	2022 年度				2,608.15	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%	2023 年度				-	
投资项目		募集资金投资总额			2024 年度				-	
					2025 年度				-	
					2026 年 1-6 月				-	
					截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期	备注
序号	**承诺投资项目**	**募集前承诺投资总额**	**募集后承诺投资总额**	**实际投资金额**	**募集前承诺投资总额**	**募集后承诺投资总额**	**实际投资金额**	**实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额**		
1	生产基地扩建项目	73,642.39	9,000.00	9,032.93	73,642.39	9,000.00	9,032.93	32.93	2024 年 4 月	
2	研发中心建设项目	4,885.51	2,000.00	2,031.72	4,885.51	2,000.00	2,031.72	31.72	2025 年 7 月	
3	补充流动资金项目	20,000.00	13,800.97	13,827.47	20,000.00	13,800.97	13,827.47	26.51	-	
合计		**98,527.90**	**24,800.97**	**24,892.13**	**98,527.90**	**24,800.97**	**24,892.13**	**91.16**	**-**	

注 1：合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五入原因所造成。

注 2：项目达到预定可使用状态日期按照可行性研究报告填列。公司“生产基地扩建项目”“研发中心建设项目”于 2024 年 3 月份结项，且项目募集后承诺投资总额已全部投入。由于实际募集资金远不及预期且公司自有资金不足，项目建设存在延期情形。综合考虑目前市场环境及募投项目实际实施进度，项目尚未达到预定可使用状态。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

（1）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 **2026 年 6 月 30 日**，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（2）前次募集资金投资项目置换情况

2021 年 5 月 20 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,722.48 万元置换截至 2021 年 3 月 29 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，及以募集资金 334.11 万元置换已支付发行费用的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了专项鉴证，并出具了《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字（2021）01103 号）。

根据该报告，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 5,722.48 万元，本次以募集资金 5,722.48 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	占募集资金拟投入金额的比例（%）
生产基地扩建项目	9,000.00	5,722.48	63.58
研发中心建设项目	2,000.00	-	-
补充流动资金项目	13,800.97	-	-
合计	**24,800.97**	**5,722.48**	**23.07**

4、闲置募集资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产

经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 **2026 年 6 月 30 日**，公司募集资金购买理财产品、大额存单及其收益的情况如下表所示：

单位：元

合作方名称（银行）	产品名称	产品类型	购买日	截止日	金额	是否已到期	收益金额
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04050 期	结构性存款保本型	2021 年 4 月 30 日	2021 年 5 月 31 日	89,070,000.00	是	230,727.90
招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款保本型	2021 年 4 月 30 日	2021 年 5 月 31 日	35,000,000.00	是	43,994.52
招商银行	招商银行单位大额存单 2020 年第 814 期	大额可转让存单保本型	2021 年 6 月 9 日	2021 年 9 月 10 日	20,000,000.00	是	153,083.34
			2021 年 6 月 9 日	2021 年 11 月 29 日		是	90,750.00
宁波银行	2021 年单位结构性存款	结构性存款保本型	2021 年 5 月 14 日	2021 年 6 月 15 日	20,000,000.00	是	17,534.25
宁波银行	定期存单	大额存单保本型	2021 年 6 月 18 日	2021 年 9 月 18 日	20,000,000.00	是	159,500.00
宁波银行	定期存单	大额存单保本型	2021 年 10 月 21 日	2022 年 1 月 21 日	20,000,000.00	是	95,502.37
合计					**204,070,000.00**	**-**	**791,092.38**

（三）前次募集资金项目的效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2026 年 6 月 30 日，前次募集资金项目的效益情况如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益[注 1]	最近三年一期实际效益[注 3]				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-6 月		
1	生产基地扩建项目	不适用[注 2]	**不适用**	不适用	不适用	**不适用**	**不适用**	不适用	不适用
2	研发中心建设项目	不适用	**不适用**	不适用	不适用	**不适用**	**不适用**	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	**不适用**	不适用	不适用	**不适用**	**不适用**	不适用	不适用
合计		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，“项目达产后，预计年销售收入 69,084.00 万元，净利润 9,222.44 万元（达产年）。”上述预计年净利润不代表公司的承诺，公司以预计效益作为参考与实际效益进行比较。

注 2：根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，“预计项目实施完成后，公司的自主生产能力将增加 216,000 万件/年，以满足公司未来业务规模扩张的需求。”生产基地扩建项目的募集前承诺投资总额为 73,642.39 万元，募集后承诺投资总额为 9,000.00 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司生产基地扩建项目投资总额未达到募集前承诺投资总额，不适用按照年产 216,000 万件/年进行累计产能利用率指标计算。

注 3：截至 2026 年 6 月 30 日，生产基地扩建项目尚未全部建成及达产，未能形成完整项目的实际效益。假设按照募投项目已投入设备占项目实施主体总设备的金额比重对效益进行简单测算，2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年 1-6 月实现效益分别为 0 万元、522.735 万元、-4,444.24 万元和-2,884.75 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，累计实现效益-6,806.26 万元。该测算结果仅为模拟测算参考，不等同于项目达产后实际可实现效益。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

研发中心建设项目主要为公司发展提供技术支撑，无法独立产生经济效益，因而无法对其经济效益做财务方面的评价。

补充流动资金有利于优化公司资产结构，提升持续盈利能力，增强整体资金实力和核心竞争力，促进公司的可持续性发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

3、前次募集资金投资项目的累计实现收益不及预期的说明

截至 **2026 年 6 月 30 日**，生产基地扩建项目尚未全部达产，未能产生实际效益，不涉及前次募集资金投资项目的累计实现收益不及预期情况。

（四）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 **2026 年 6 月 30 日**，公司前次募投项目募集资金已使用完毕。

二、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用

公司主要从事消费电子光学、汽车电子、电子陶瓷等领域精密电子零部件产品研发、设计、生产和销售。公司通过产品的自主工艺设计、模具自主开发和精密加工为支撑，依托冲压、电镀、注塑、SMT、芯片封装测试、组装等先进工艺及配套的自动化装备研制能力和产品创新能力，为客户提供精密电子零部件产品和集成方案的一体化制造。凭借在消费电子领域拥有的成熟工艺和技术，公司积极开拓汽车电子市场、电子陶瓷市场。

根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》及国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》和《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司所属行业属于战略性新兴产业的重要组成部分。公司所属行业领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》第五条规定的“（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”。公司前次募集资金投资项目是从公司战略角度出发，对现有主营业务产品产能的扩建以及对公司研发实力的提升。公司前次募集资金实际所投资的领域，属于具有科技创新属性的新一代信息技

术领域。

综上，公司前次募集资金实际投向属于科技创新领域。

三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 **2026 年 9 月 18 日**出具了**“天衡专字(2026)01611 号”**《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，认为：昀冢科技公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了昀冢科技公司截至 **2026 年 6 月 30 日**的前次募集资金使用情况。

第六章 与本次发行相关的风险因素

一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

（一）核心竞争力风险

1、竞争加剧的风险

公司所处其他电子元件制造业产品众多，行业市场化程度较高，竞争较为激烈。尽管公司在精密零部件细分领域具有一定的技术、设备、客户、人才等优势，但下游产品技术迭代快，同行业竞争对手的技术水平也不断随之发展，如果公司在激烈的市场竞争中不能有效整合资源、及时开发新品、响应客户需求、提高产品质量，或者公司不能在现有产品领域及新应用领域进行有效的市场开拓，将面临市场份额下降及盈利能力下滑的风险。

2、终端用户产品升级的风险

公司产品客户定制化程度较高，受终端用户产品需求影响较大。终端用户的技术升级和产品迭代速度较快，这要求公司对于客户需求能准确把握、快速响应，同时拥有较强的技术研发能力以实现产品的升级迭代，甚至先于客户需求判断行业趋势并提前进行新技术和新产品研发。如果公司在后续研发过程中对研发方向判断失误或研发进度缓慢，将面临无法满足终端用户技术升级及产品迭代需求，进而被竞争对手抢占市场份额的风险。

3、技术创新风险

随着手机光学领域终端产品不断向高像素、高响应度、小型化、轻量化方向发展，公司产品技术创新和开发的难度更高、综合性能更为全面，产品升级换代速度更快。同时，为及时响应下游客户及终端用户的产品创新需求，公司需要具备快速响应下游客户需求乃至与客户协同研发的能力，这对技术创新和开发能力提出了更高的要求。如果公司无法及时跟上行业技术升级换代的步伐，公司产品竞争力将无法持续提升，盈利能力将受到影响。

4、技术人才流失及核心技术泄密的风险

作为精密电子零部件行业的高新技术企业，高素质的人才对公司未来的发展举足轻重。基于技术团队在精密电子零部件领域突出的研发创新能力，公司逐步建立起业内竞争优势。虽然正常的人才流动不会对公司的研发和经营造成重大不利影响，且公司与主要技术人员签署了竞业禁止协议，但如果主要技术人员大量流失，则可能对公司的研发和生产活动产生不利影响，进而影响公司经营业绩。

（二）经营风险

1、原材料价格波动的风险

公司生产经营采购的主要原材料包括塑料粒子、模具零件、金属、传感器及 IC 芯片、陶瓷薄片等。其中，塑料、金属类原材料属于大宗商品，其价格波动主要受宏观经济形势影响，传感器和 IC 芯片价格受下游行业周期和市场供需变化影响也较为明显。目前，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，但若因市场供求变化、不可抗力等因素导致上述主要原材料采购价格发生大幅上升或原材料短缺，公司的盈利能力将可能受到不利影响。池州昀冢 MLCC 产品生产所需的部分原材料和设备涉及进口，汇率波动可能对公司采购成本产生一定影响。

2、产品市场拓展的风险

公司在汽车领域形成销售，产销量呈现增长趋势。公司虽通过京西重工、万向精工、捷太格特、三井金属、拿森汽车、东洋电装等汽车领域客户认证，并已获得汽车领域客户定点生产计划书，将按照客户备货计划生产和销售，但汽车类精密电子零部件产品普遍认证周期较长，可能存在产品认证周期中因终端客户战略调整导致终止认证的情况；除此之外，由于公司涉足汽车类精密电子零部件领域时间较短，在集成零部件产品上的研发经验相对较少，因此可能面临集成汽车精密电子零部件拓展缓慢的情况，将会对公司未来业绩的增长造成不利影响。

公司未来在前述领域的产品销售收入存在一定的不确定性，如未来公司在汽车领域不能持续开拓新产品和客户，将无法在上述领域实现可持续增长，进而对公司未来业绩的增长造成不利影响。

3、产品价格下降的风险

随着手机光学领域终端产品不断向高像素、高响应度、小型化、轻量化方向发展，产品更新换代相对较快，既有产品的平均单价在同系列新产品推出后将有所下降，同时下游客户对成本控制的日益加强、行业内竞争日趋激烈也将使得公司主要产品平均售价存在下降风险，公司产品价格的下降可能对公司未来的经营业绩及财务状况造成不利影响。

4、直接客户及终端用户集中度较高的风险

公司直接客户主要为各大 VCM 马达厂商和 CCM 模组厂商，公司坚持的优质客户发展战略使得公司存在客户集中度较高的情况。目前，重点客户的销售订单对于公司的经营业绩有较大影响，如果该等客户的经营或财务状况出现不良变化，或者公司与其稳定的合作关系发生变动，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

公司产品终端用户主要为华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、传音等手机终端厂商，报告期内，终端用户集中度也较高。如果未来公司产品质量、创新能力不能满足终端用户需求，可能对公司未来盈利能力造成不利影响。

5、经营规模扩张引致的管理风险

报告期内，公司业务规模和资产规模快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度。上市后，随着投资项目的实施，经营规模的进一步扩大将要求公司在战略投资、运营管理、内部控制等方面随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制、加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对经营规模快速扩张等导致的内外环境变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

6、不能持续通过客户认证的风险

公司客户在引入新的供应商时，通常会进行供应商考察认证，通过认证的供应商方可进入其合格供应商资源池，客户才会与供应商建立正式商业合作关系。在首次取得客户认证后，客户会定期/不定期以稽核方式考察公司是否依然满足合格供应商的要求。因此，若公司不能持续获得重要客户的认证，将面临经营业绩增速放缓的风险。

7、MLCC 项目的投资风险

报告期内，公司主营业务由原消费电子业务转换为消费电子、电子陶瓷业务双线发展。公司 MLCC 项目具有前期资金投入大、投资周期长等特点，如果未来行业竞争加剧、行业技术发展趋势发生难以预见的变化、下游行业需求发生重大变化，存在项目效益不及预期的风险。公司 MLCC 项目资金来源为自有资金及自筹资金，可能存在因资金紧张带来的项目投资进度放缓的风险，并存在持续亏损的风险。

（三）财务风险

1、应收账款坏账风险

截至 2026 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 19,746.11 万元，占期末资产总额的比例为 10.75%，应收账款占比较大。一方面，应收账款金额占用了公司的运营资金，影响资金周转效率；另一方面，若市场环境或客户运营状况发生风险因素，将使公司应收账款产生坏账风险，导致应收账款不能及时回收，进而可能对公司资金使用效率和经营业绩造成不利影响。

2、固定资产投资和减值风险

截至 2026 年 6 月 30 日，公司固定资产账面价值为 94,081.55 万元，占期末资产总额的比例为 51.20%。公司固定资产规模较大，受产能利用率不足、工艺技术升级、日常保养等因素的影响，存在资产减值的风险。未来，若应用市场需求的重大变化、产品转型升级发生重大变革，或出现其他更为领先的工艺技术，将导致公司固定资产出现减值的风险。公司重点投资的 MLCC 项目，前期固定资产投入占比高，相关折旧摊销金额大，若未来 MLCC 市场业务开拓不及预期，MLCC 业务营业收入未能按计划增长，公司的盈利空间可能存在进一步收窄的风险。上述情况将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。

3、毛利率波动的风险

报告期内，公司的营业毛利率分别为 18.75%、14.04%、3.07%和 0.38%，呈现持续下降趋势。随着行业内竞争格局的变化，将可能导致公司下游市场需求出现波动。此外，公司的技术创新能力、产品的更新迭代周期、供应链管理水平、下游市场竞争等均会影响毛利率。以上因素若发生重大不利变化，将可

能对公司产品的毛利率产生较大的负面影响。

4、存货跌价风险

报告期各期末，存货跌价准备金额分别为 870.33 万元、2,094.74 万元、2,725.72 万元和 1,530.81 万元，总体金额较高，占各期末存货原值的比例分别为 8.52%、19.48%、18.65%和 9.78%。同时，报告期内存货报废的金额分别为 1,065.87 万元、750.64 万元、274.07 万元和 188.63 万元。若未来外部环境发生不利变化，或公司自身新产品销售未达预期，进而造成存货的积压与滞销，可能对公司的业绩造成不利影响。

5、偿债压力和流动性风险

报告期内，公司资产负债率分别为 81.50%、87.03%、92.33%和 89.20%，流动比率分别为 0.68、0.51、0.41 和 0.41，速动比率分别为 0.55、0.39、0.27 和 0.29，资产负债率较高，长短期偿债能力较弱且持续下降。报告期内，公司归母净利润分别为-12,613.89 万元、-12,394.93 万元、-19,006.26 万元和-9,126.49 万元，在报告期前三年亏损持续扩大。截至 2026 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 3.35 亿元，一年以内到期的长期借款余额为 0.71 亿元，长期借款余额为 4.31 亿元。如果公司未来的经营业绩和经营活动现金流量出现不利变化，或者与相关金融机构的合作关系出现不利变化，可能导致公司面临较大的偿债压力和流动性风险，进而影响公司持续经营能力。

（四）行业风险

公司产品应用于智能手机、通讯、汽车电子等领域，业务发展可能会受到下游应用市场的影响。如果未来宏观经济形势发生剧烈波动，导致下游应用市场对公司产品需求减少，或电子信息产业政策发生重大不利变化，将在一定程度上限制公司的发展，可能对公司业务发展造成不利影响。

（五）宏观环境风险

近年来，随着国际贸易环境的不确定性，部分国家对公司部分终端客户存在一定限制，可能会使终端客户对上游精密零部件、VCM 马达和 CCM 光学模组等手机光学元器件的需求有所延后。若未来国际贸易环境发生重大不利变化，中美贸易摩擦进一步升级或限制规则持续，将对公司未来业绩增长造成不利影

响。

（六）业绩下滑或亏损的风险

报告期内，公司净利润处于亏损状态，一方面由于新业务 MLCC 投资项目具有重资产、高技术壁垒属性，其前期厂房建设、设备购置等投入规模庞大，伴随子公司池州昀冢在建工程转固导致折旧等相关费用大幅增加，叠加人工、材料等运营成本增加，导致公司处于亏损状态；另一方面，公司消费电子业务有所下滑，期间费用较高，进一步加剧了业绩亏损的情况。

如果发生市场竞争加剧、宏观景气度下行、需求持续低迷、国家产业政策变化、公司不能有效拓展客户、公司无法继续维系与现有客户的合作关系等情形，且公司未能及时采取措施积极应对，将使公司面临一定的经营压力，存在业绩下滑、持续亏损的风险。

二、本次发行相关风险

（一）募投项目实施的风险

本次发行募集资金将用于“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”“补充流动资金及偿还银行贷款项目”。公司已就本次募集资金投资项目进行了详细市场调研与严格的可行性论证，本次募投项目建设是基于客户需求、市场前景、经营战略等做出的审慎决策。在募投项目实施过程中，公司将严格按照预定计划推进项目落地，但若因宏观环境、经济政策变化等不可预见的因素导致开发进度、投资成本等方面出现不利变化，将可能导致募投项目建设周期延长或项目实施效果低于预期，进而对公司经营产生不利影响。

（二）募投项目效益未达预期的风险

本次募集资金投资项目的实施进度和实施效果存在一定的不确定性。虽然本次募投项目与公司现有主营业务密切相关,公司对募集资金投资项目经过认真的可行性分析及论证，并在人员、技术、市场等方面进行了充分的准备，但是在项目实施过程中，仍可能存在因项目进度、投资成本和市场需求发生变化等原因造成的效益未达预期的风险。

（三）募投项目新增资产折旧摊销影响公司业绩的风险

本次募投项目中包含较大规模的资本性支出，项目建成后，相应折旧摊销费用将显著增加。考虑到募投项目从建设到全面达产以及市场消化新增产能需要一定周期，在项目效益尚未充分释放的阶段，新增折旧摊销将在一定程度上影响公司短期盈利水平。若未来市场环境发生不利变化，导致募投项目实际效益低于预期，则新增折旧摊销将对公司未来经营业绩造成不利影响。

（四）即期收益被摊薄的风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果公司业绩暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成后公司的即期回报（每股收益等财务指标）将存在被摊薄的风险。

（五）股票价格波动风险

公司股票在上交所科创板上市，公司股票价格除受公司经营状况、财务状况等基本面因素影响外，还会受到政治、宏观经济形势、经济政策或法律变化、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期以及其他不可预测因素的影响。

（六）审批风险

本次向特定对象发行股票尚需取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。该等审批事项的结果存在不确定性。

第七章 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王 宾　　翁 莹　　季春勇

胡 炜　　刘文柏　　莫凑全

龚菊明　　曹瑞武　　董学立

全体审计委员会成员签名：

龚菊明　　董学立　　胡 炜

全体非董事高级管理人员签名：

陈 艳　　颜荣崑

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2026 年 10 月 23 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人：王宾

王 宾

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2026 年 10 月 23 日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

殷笑天

保荐代表人：

孙海旺　　郑云洁

法定代表人：

王苏望

国投证券股份有限公司

2026 年 10 月 23 日

保荐人（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总经理：

廖笑非

国投证券股份有限公司

2026年10月23日

保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

董事长：

王苏望

国投证券股份有限公司

2026 年 10 月 23 日

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：_____ _____

赵丽君 陈炜

律师事务所负责人：_____

沈国权

上海市锦天城律师事务所

2026 年 10 月 23 日

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字会计师：

吴景亚　　庄培娜

会计师事务所负责人：

郭澳

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年10月23日

董事会声明

一、关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

除本次发行外，在未来十二个月内，公司董事会将根据公司资本结构、业务发展情况，考虑公司的融资需求以及资本市场发展情况综合确定是否安排其他股权融资计划，并按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

二、关于填补本次发行摊薄即期回报的具体措施和承诺

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，为了保护投资者利益，公司采取以下措施提升公司竞争力，以填补股东回报。

（一）加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司已制定《募集资金管理制度》，明确了公司对募集资金专户存储、使用、管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，并进行专款专用，以保证募集资金合理规范使用。

（二）积极落实募集资金投资项目，助力公司业务发展

本次募集资金投资项目的实施，将推动公司业务发展，提高公司市场竞争力，为公司的战略发展带来积极影响。本次发行募集资金到位后，公司将积极推进募集资金投资项目，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

（三）不断完善公司治理，加强经营管理和内部控制

公司将不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益。公司将努力提高资金的使用效率，控制资金成本，认真规划各项费用支出平稳有序，全面有效地控制经营和管控风险，保障公司持续、稳定、健康发展。

（四）完善利润分配政策，优化投资者回报机制

为不断完善公司持续、稳定的利润分配政策、分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》等规定，公司结合自身实际情况，制定了《苏州昀冢电子科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。本次发行完成后，公司将严格执行现金分红政策，切实保障投资者的权益。

三、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

“一、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；

二、对职务消费行为进行约束；

三、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

四、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩；

五、若公司未来实施新的股权激励计划，拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

六、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；

七、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（二）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺

为确保公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，

维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

二、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

三、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。”

（本页无正文，为《苏州昀冢电子科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》之董事会声明盖章页）

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2026年10月23日